

有研半导体硅材料股份公司

2025 年度财务报表及审计报告

有研半导体硅材料股份公司

2025 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 6
2025 年度财务报表	
合并资产负债表	1 - 2
公司资产负债表	3 - 4
合并利润表	5
公司利润表	6
合并现金流量表	7
公司现金流量表	8
合并股东权益变动表	9 - 10
公司股东权益变动表	11 - 12
财务报表附注	13 - 112
补充资料	1

## 审计报告

普华永道中天审字(2026)第 10003 号

(第一页, 共六页)

有研半导体硅材料股份公司全体股东:

### 一、 审计意见

#### (一) 我们审计的内容

我们审计了有研半导体硅材料股份公司(以下简称“有研硅”)的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### (二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了有研硅 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于有研硅,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2026)第 10003 号

(第二页, 共六页)

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为“产品销售收入的确认”。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p><b>产品销售收入的确认</b></p> <p>请参阅合并财务报表附注二(24)“主要会计政策和会计估计-收入”、附注四(34)“营业收入和营业成本”。</p> <p>有研硅 2025 年度合并营业收入为人民币 1,005,245,724.48 元,其中产品销售收入为人民币 981,106,108.47 元,约占当年营业收入的 97.60%。</p> <p>有研硅在客户取得相关产品的控制权时,按预期有权收取的对价金额确认收入。</p> <p>根据销售合同或销售订单的约定,不同产品销售收入的确认时点分为以下两种情况:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>对于国内销售收入,有研硅按照合同约定将产品运至约定的交货地点,由购买方接受并签收时确认收入或者按照合同约定由购买方自提,于购买方提货时确认收入;</li></ul>	<p>我们针对产品销售收入确认实施的审计程序包括:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>了解、评价并测试管理层产品销售收入相关内部控制;</li><li>了解有研硅产品销售收入确认的会计政策,抽样检查产品销售合同并分析合同中的相关条款,评价产品销售收入确认的会计政策是否恰当;</li><li>抽样检查与产品销售收入确认相关的支持性文件,包括与国内销售收入相关的销售合同、销售订单、客户签收单、销售发票等,以及与国外销售收入相关的销售合同、销售订单、报关单、客户提货单、物流信息等适用的支持性文件;</li><li>基于交易金额和客户特点的考虑,采用抽样的方式,向特定客户函证本年度产品销售收入确认金额及应收账款余额;</li></ul>

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2026)第 10003 号

(第三页, 共六页)

### 三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p><b>产品销售收入的确认(续)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>对于国外销售收入, 根据相关贸易条款, 在购买方取得产品控制权时确认收入。</li></ul> <p>由于产品销售收入占营业收入比重重大且金额重大, 我们在审计工作中投入了大量的审计资源, 因此我们将其作为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>针对资产负债表日前后确认的产品销售收入, 检查国内销售的客户签收单或销售发票, 以及国外销售的报关单、客户提货单、物流信息, 以评估产品销售收入是否记录在恰当的会计期间;</li></ul> <p>根据所实施的审计程序, 我们获取的审计证据可以支持有研硅产品销售收入的确认。</p>

### 四、 其他信息

有研硅管理层对其他信息负责。其他信息包括有研硅 2025 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2026)第 10003 号

(第四页, 共六页)

### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

有研硅管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估有研硅的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算有研硅、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督有研硅的财务报告过程。

### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2026)第 10003 号

(第五页, 共六页)

### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对有研硅持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致有研硅不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就有研硅中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2026)第 10003 号

(第六页, 共六页)

### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



普华永道中天会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·上海市  
2026年3月25日

注册会计师

注册会计师

汪超  
汪超 (项目合伙人)

张建隆  
张建隆

有研半导体硅材料股份公司

2025年12月31日合并资产负债表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资产	附注	2025年12月31日 合并	2024年12月31日 合并
<b>流动资产</b>			
货币资金	四(1)	666,868,072.72	1,029,893,380.40
交易性金融资产	四(2)	1,910,302,191.79	1,910,071,561.64
应收票据	四(3)	68,497,962.62	74,479,689.41
应收账款	四(4)	291,784,115.63	209,112,419.43
应收款项融资	四(5)	90,341,764.46	129,563,009.25
预付款项	四(6)	52,153,065.51	16,130,945.05
其他应收款	四(7)	5,160,921.70	487,015.12
存货	四(8)	218,350,745.18	209,424,045.33
其他流动资产	四(9)	7,767,319.59	9,040,232.63
<b>流动资产合计</b>		<b>3,311,226,159.20</b>	<b>3,588,202,298.26</b>
<b>非流动资产</b>			
长期股权投资	四(11)	686,711,374.61	350,511,948.72
其他非流动金融资产	四(10)	30,000,000.00	30,000,000.00
固定资产	四(12)	1,303,730,469.15	1,027,313,509.72
在建工程	四(13)	60,853,016.17	246,835,396.49
使用权资产	四(14)	5,298,582.31	6,853,455.68
无形资产	四(15)	80,376,359.92	80,750,147.87
长期待摊费用	四(17)	9,245,853.04	5,624,403.02
递延所得税资产	四(18)	6,247,235.81	5,625,377.31
其他非流动资产	四(19)	770,281.80	26,051,820.49
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,183,233,172.81</b>	<b>1,779,566,059.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,494,459,332.01</b>	<b>5,367,768,357.56</b>

有研半导体硅材料股份公司

2025年12月31日合并资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债和股东权益	附注	2025年12月31日 合并	2024年12月31日 合并
<b>流动负债</b>			
应付票据	四(21)	46,555,914.88	115,721,960.05
应付账款	四(22)	140,254,547.92	114,984,070.90
合同负债		2,627,591.75	674,946.21
应付职工薪酬	四(23)	37,459,269.04	37,039,556.40
应交税费	四(24)	11,775,008.62	17,493,380.99
其他应付款	四(25)	107,052,492.96	87,248,694.13
一年内到期的非流动负债	四(26)	4,153,084.43	4,858,613.87
<b>流动负债合计</b>		<b>349,877,909.60</b>	<b>378,021,222.55</b>
<b>非流动负债</b>			
租赁负债	四(27)	1,365,817.00	2,118,850.46
递延收益	四(28)	136,072,234.60	190,683,646.81
递延所得税负债	四(18)	35,829.40	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>137,473,881.00</b>	<b>192,802,497.27</b>
<b>负债合计</b>		<b>487,351,790.60</b>	<b>570,823,719.82</b>
<b>股东权益</b>			
股本	一、四(29)	1,250,301,858.00	1,247,621,058.00
资本公积	四(30)	2,297,904,835.15	2,257,339,498.13
减: 库存股	四(31)	(35,935,687.59)	(35,935,687.59)
专项储备	二(19)	9,933,457.07	8,584,634.90
盈余公积	四(32)	40,023,401.77	35,332,565.28
未分配利润	四(33)	958,590,829.30	828,644,971.51
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>4,520,818,693.70</b>	<b>4,341,587,040.23</b>
少数股东权益		486,288,847.71	455,357,597.51
<b>股东权益合计</b>		<b>5,007,107,541.41</b>	<b>4,796,944,637.74</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>5,494,459,332.01</b>	<b>5,367,768,357.56</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 张果虎

主管会计工作的负责人: 杨波

会计机构负责人: 李文彬

有研半导体硅材料股份公司

2025年12月31日公司资产负债表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资产	附注	2025年12月31日 公司	2024年12月31日 公司
<b>流动资产</b>			
货币资金		284,850,121.78	573,161,656.49
交易性金融资产		670,097,260.28	750,023,972.60
应收票据		7,115,680.26	7,368,235.31
应收账款	十六(1)	31,080,387.00	8,898,185.79
应收款项融资		3,421,202.92	1,110,276.08
预付款项		50,352,325.08	2,554,957.60
其他应收款	十六(2)	4,869,950.39	33,658.25
存货		11,486,686.27	19,084,961.81
其他流动资产		575,823.40	808,777.74
<b>流动资产合计</b>		<b>1,063,849,437.38</b>	<b>1,363,044,681.67</b>
<b>非流动资产</b>			
长期股权投资	十六(3)	2,629,288,604.66	2,317,822,308.03
其他非流动金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
固定资产		83,784,183.95	74,021,390.81
在建工程		3,657,780.88	3,757,644.79
使用权资产		2,791,578.46	6,513,682.78
无形资产		657,055.80	1,039,261.84
长期待摊费用		892,412.91	2,082,296.67
递延所得税资产		4,899,224.67	3,150,494.31
其他非流动资产		-	155,309.73
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,755,970,841.33</b>	<b>2,438,542,388.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,819,820,278.71</b>	<b>3,801,587,070.63</b>

有研半导体硅材料股份公司

2025年12月31日公司资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债和股东权益	附注	2025年12月31日 公司	2024年12月31日 公司
<b>流动负债</b>			
应付票据		11,115,003.11	-
应付账款		22,357,027.15	18,064,877.49
合同负债		-	32,809.61
应付职工薪酬		22,399,526.03	23,670,030.20
应交税费		1,834,501.26	7,833,501.84
其他应付款		8,560,735.58	9,587,367.80
一年内到期的非流动负债		3,153,267.09	4,732,878.83
<b>流动负债合计</b>		<b>69,420,060.22</b>	<b>63,921,465.77</b>
<b>非流动负债</b>			
租赁负债		-	1,932,446.31
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>1,932,446.31</b>
<b>负债合计</b>		<b>69,420,060.22</b>	<b>65,853,912.08</b>
<b>股东权益</b>			
股本		1,250,301,858.00	1,247,621,058.00
资本公积		2,294,189,361.59	2,253,458,866.89
减: 库存股		(35,935,687.59)	(35,935,687.59)
专项储备	二(19)	4,715,949.23	4,561,189.08
盈余公积		40,023,401.77	35,332,565.28
未分配利润		197,105,335.49	230,695,166.89
<b>股东权益合计</b>		<b>3,750,400,218.49</b>	<b>3,735,733,158.55</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>3,819,820,278.71</b>	<b>3,801,587,070.63</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 张果虎

主管会计工作的负责人: 杨波

会计机构负责人: 李文彬

有研半导体硅材料股份公司

2025 年度合并利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2025 年度 合并	2024 年度 合并
一、营业收入	四(34)	1,005,245,724.48	995,945,853.09
减：营业成本	四(34)、四(40)	(636,140,413.43)	(630,742,120.87)
税金及附加	四(35)	(13,871,070.83)	(7,056,703.16)
销售费用	四(36)、四(40)	(16,020,375.25)	(14,059,250.48)
管理费用	四(37)、四(40)	(45,814,401.27)	(39,082,890.66)
研发费用	四(38)、四(40)	(92,414,261.56)	(78,280,741.45)
财务费用	四(39)	6,494,150.87	20,516,234.10
其中：利息费用		(203,196.71)	(338,852.82)
利息收入		9,545,308.11	20,445,299.09
加：其他收益	四(43)	96,572,942.82	60,786,383.75
投资损失	四(44)	(12,677,054.95)	(4,944,258.24)
其中：对联营企业的投资损失		(49,845,938.36)	(35,179,165.13)
公允价值变动收益	四(45)	1,754,047.18	13,297,438.35
信用减值损失	四(42)	(1,085,878.51)	(939,419.65)
资产减值(损失)/转回	四(41)	(5,517,863.98)	2,637,491.56
资产处置收益	四(46)	77,610.72	84,500.61
二、营业利润		286,603,156.29	318,162,516.95
加：营业外收入	四(47)	819,157.56	1,482,195.67
减：营业外支出	四(48)	(219,368.10)	(1,351,379.24)
三、利润总额		287,202,945.75	318,293,333.38
减：所得税费用	四(49)	(41,199,169.06)	(49,066,337.47)
四、净利润		246,003,776.69	269,226,995.91
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		246,003,776.69	269,226,995.91
归属于母公司股东的综合收益总额		209,280,637.60	232,903,753.41
归属于少数股东的综合收益总额		36,723,139.09	36,323,242.50
七、每股收益			
基本每股收益(人民币元)	四(50)	0.17	0.19
稀释每股收益(人民币元)	四(50)	0.17	0.19

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：张果虎

主管会计工作的负责人：杨波

会计机构负责人：李文彬

有研半导体硅材料股份公司

2025年度公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2025年度 公司	2024年度 公司
一、营业收入	十六(4)	189,518,533.57	184,188,092.55
减：营业成本	十六(4)	(118,167,528.21)	(106,871,555.14)
税金及附加		(1,779,995.16)	(1,227,676.97)
销售费用		(3,906,794.63)	(2,988,586.35)
管理费用		(28,672,532.59)	(24,466,337.97)
研发费用		(12,057,547.63)	(11,761,074.79)
财务费用		1,576,734.10	7,876,795.88
其中：利息费用		(161,113.22)	(319,719.77)
利息收入		1,921,033.60	7,909,326.14
加：其他收益		3,914,116.90	4,763,847.83
投资收益	十六(5)	24,953,448.00	63,125,337.04
其中：对联营企业的投资损失		(50,950,979.22)	(35,179,165.13)
公允价值变动收益		415,703.58	5,607,191.77
信用减值(损失)/转回		(302,392.59)	66,979.11
资产减值损失		(539,947.79)	(25,175.52)
资产处置收益		77,610.72	84,500.61
二、营业利润		55,029,408.27	118,372,338.05
加：营业外收入		231,122.18	1,230,188.43
减：营业外支出		(194.75)	(602,847.03)
三、利润总额		55,260,335.70	118,999,679.45
减：所得税费用		(8,351,970.84)	(18,177,679.32)
四、净利润		46,908,364.86	100,822,000.13
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		46,908,364.86	100,822,000.13

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：张果虎



主管会计工作的负责人：杨波



会计机构负责人：李文彬



有研半导体硅材料股份公司

2025年度合并现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	2025年度 合并	2024年度 合并
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		786,821,820.18	695,326,154.13
收到的税费返还		9,924,210.42	16,941,938.91
收到其他与经营活动有关的现金	四(51)(a)	55,653,086.35	62,927,480.71
经营活动现金流入小计		852,399,116.95	775,195,573.75
购买商品、接受劳务支付的现金		(317,271,481.71)	(322,736,992.02)
支付给职工以及为职工支付的现金		(166,263,083.00)	(149,187,196.14)
支付的各项税费		(68,235,399.70)	(48,922,354.68)
支付其他与经营活动有关的现金	四(51)(b)	(26,438,489.15)	(24,981,056.15)
经营活动现金流出小计		(578,208,453.56)	(545,827,598.99)
经营活动产生的现金流量净额	四(52)(a)	274,190,663.39	229,367,974.76
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	四(51)(c)	8,290,000,000.00	9,480,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		33,307,931.59	45,414,276.75
处置固定资产收回的现金净额		110,695.68	8,816.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	四(52)(d)	2,513,510.16	-
收到其他与投资活动有关的现金	四(51)(d)	21,732,043.82	2,630,349.81
投资活动现金流入小计		8,347,664,181.25	9,528,053,443.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(143,788,957.53)	(218,670,093.63)
投资支付的现金	四(51)(e)	(8,670,000,000.00)	(10,040,000,000.00)
支付其他与投资活动有关的现金	四(51)(f)	(37,618,611.67)	(5,000,000.17)
投资活动现金流出小计		(8,851,407,569.20)	(10,263,670,093.80)
投资活动使用的现金流量净额		(503,743,387.95)	(735,616,650.74)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		34,061,240.00	1,181,388.80
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	1,181,388.80
筹资活动现金流入小计		34,061,240.00	1,181,388.80
分配股利支付的现金		(85,725,739.32)	(27,416,057.22)
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		(11,081,796.00)	(14,975,400.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	四(51)(g)	(4,403,315.47)	(39,320,793.25)
筹资活动现金流出小计		(90,129,054.79)	(66,736,850.47)
筹资活动使用的现金流量净额		(56,067,814.79)	(65,555,461.67)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		(1,936,876.12)	532,242.44
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>			
加: 年初现金及现金等价物余额	四(52)(c)	(287,557,415.47)	(571,271,895.21)
		905,848,935.90	1,477,120,831.11
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>			
	四(52)(f)	618,291,520.43	905,848,935.90

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 张果虎 主管会计工作的负责人: 杨波 会计机构负责人: 李文彬

张果虎印

- 7 -

杨波印

李文彬印

有研半导体硅材料股份公司

2025年度公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2025年度 公司	2024年度 公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,811,934.92	179,942,458.77
收到的税费返还	357,107.15	3,421,835.54
收到其他与经营活动有关的现金	52,485,162.56	65,271,672.85
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>187,654,204.63</b>	<b>248,635,967.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(90,863,966.28)	(68,130,313.47)
支付给职工以及为职工支付的现金	(82,433,316.60)	(77,413,738.71)
支付的各项税费	(24,134,551.80)	(14,860,599.35)
支付其他与经营活动有关的现金	(8,502,110.78)	(16,128,530.87)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(205,933,945.46)</b>	<b>(176,533,182.40)</b>
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	(18,279,740.83)	72,102,784.76
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	3,190,000,000.00	4,110,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	75,440,723.44	104,812,378.87
处置固定资产收回的现金净额	110,695.68	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,400,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	9,047.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,278,951,419.12</b>	<b>4,214,821,425.87</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(15,940,090.02)	(807,143.74)
投资支付的现金	(3,490,000,000.00)	(4,368,526,638.08)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(3,505,940,090.02)</b>	<b>(4,369,333,781.82)</b>
投资活动使用的现金流量净额	(226,988,670.90)	(154,512,355.95)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	24,261,240.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>24,261,240.00</b>	<b>-</b>
分配股利支付的现金	(74,643,943.32)	(12,440,657.22)
支付其他与筹资活动有关的现金	(3,673,171.27)	(38,973,770.53)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(78,317,114.59)</b>	<b>(51,414,427.75)</b>
筹资活动使用的现金流量净额	(54,055,874.59)	(51,414,427.75)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(102,251.50)</b>	<b>206,626.01</b>
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>	<b>(299,426,537.82)</b>	<b>(133,617,372.93)</b>
加：年初现金及现金等价物余额	573,161,656.49	706,779,029.42
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>273,735,118.67</b>	<b>573,161,656.49</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：张果虎

主管会计工作的负责人：杨波

会计机构负责人：李文彬



张果虎

杨波

李文彬

有研半导体硅材料股份公司

2025年度合并股东权益变动表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
2024年1月1日年初余额		1,247,621,058.00	2,250,624,106.66	-	6,238,759.56	25,250,365.27	618,264,075.33	4,147,998,364.82	432,563,960.78	4,580,562,325.60
2024年度增减变动额										
综合收益总额										
净利润	四(33)	-	-	-	-	-	232,903,753.41	232,903,753.41	36,323,242.50	269,226,995.91
股东投入和减少资本										
股东投入资本	四(30)	-	48,527.83	-	-	-	-	48,527.83	1,132,860.97	1,181,388.80
股份支付计入股东权益的金额		-	6,312,480.28	-	-	-	-	6,312,480.28	42,733.08	6,355,213.36
利润分配										
提取盈余公积	四(32)	-	-	-	-	10,082,200.01	(10,082,200.01)	-	-	-
对母公司股东的分配	四(33)	-	-	-	-	-	(12,440,657.22)	(12,440,657.22)	-	(12,440,657.22)
对子公司少数股东的分配		-	-	-	-	-	-	-	(14,975,400.00)	(14,975,400.00)
专项储备										
本年提取		-	-	-	4,344,634.95	-	-	4,344,634.95	488,347.73	4,832,982.68
本年使用		-	-	-	(1,998,759.61)	-	-	(1,998,759.61)	(218,147.55)	(2,216,907.16)
股份回购	四(31)	-	-	(35,935,687.59)	-	-	-	(35,935,687.59)	-	(35,935,687.59)
权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动	四(30)	-	354,383.36	-	-	-	-	354,383.36	-	354,383.36
2024年12月31日年末余额		<u>1,247,621,058.00</u>	<u>2,257,339,498.13</u>	<u>(35,935,687.59)</u>	<u>8,584,634.90</u>	<u>35,332,565.28</u>	<u>828,644,971.51</u>	<u>4,341,587,040.23</u>	<u>455,357,597.51</u>	<u>4,796,944,637.74</u>

有研半导体硅材料股份有限公司

2025年度合并股东权益变动表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
		股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
2025年1月1日年初余额		1,247,621,058.00	2,257,339,498.13	(35,935,687.59)	8,584,634.90	35,332,565.28	828,644,971.51	4,341,587,040.23	455,357,597.51	4,796,944,637.74
2025年度增减变动额										
综合收益总额										
净利润	四(33)	-	-	-	-	-	209,280,637.60	209,280,637.60	36,723,139.09	246,003,776.69
股东投入和减少资本										
股东投入资本	四(29)、 四(30)	2,680,800.00	32,409,998.89	-	-	-	-	35,090,798.89	9,800,000.00	44,890,798.89
股份支付计入股东权益的金额		-	8,022,649.70	-	-	-	-	8,022,649.70	136,758.70	8,159,408.40
利润分配										
提取盈余公积	四(32)	-	-	-	-	4,690,836.49	(4,690,836.49)	-	-	-
对母公司股东的分配	四(33)	-	-	-	-	-	(74,643,943.32)	(74,643,943.32)	-	(74,643,943.32)
对子公司少数股东的分配		-	-	-	-	-	-	-	(11,081,796.00)	(11,081,796.00)
专项储备										
本年提取		-	-	-	3,806,098.22	-	-	3,806,098.22	506,645.48	4,312,743.70
本年使用		-	-	-	(2,457,276.05)	-	-	(2,457,276.05)	(296,335.10)	(2,753,611.15)
权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动	四(11)、 四(30)	-	132,688.43	-	-	-	-	132,688.43	-	132,688.43
其他										
处置子公司	五	-	-	-	-	-	-	-	(4,857,161.97)	(4,857,161.97)
2025年12月31日年末余额		1,250,301,858.00	2,297,904,835.15	(35,935,687.59)	9,933,457.07	40,023,401.77	958,590,829.30	4,520,818,693.70	486,288,847.71	5,007,107,541.41

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。



企业负责人: 张果虎

主管会计工作的负责人: 杨波

会计机构负责人: 李文彬

有研半导体硅材料股份公司

2025年度公司股东权益变动表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2024年1月1日年初余额		1,247,621,058.00	2,246,749,270.17	-	3,749,407.11	25,250,365.27	152,396,023.99	3,675,766,124.54
2024年度增减变动额								
综合收益总额								
净利润		-	-	-	-	-	100,822,000.13	100,822,000.13
股东投入和减少资本								
股份支付计入股东权益的金额		-	6,355,213.36	-	-	-	-	6,355,213.36
利润分配								
提取盈余公积	四(32)	-	-	-	-	10,082,200.01	(10,082,200.01)	-
对股东的分配	四(33)	-	-	-	-	-	(12,440,657.22)	(12,440,657.22)
专项储备								
本年提取		-	-	-	1,571,983.08	-	-	1,571,983.08
本年使用		-	-	-	(760,201.11)	-	-	(760,201.11)
股份回购	四(31)	-	-	(35,935,687.59)	-	-	-	(35,935,687.59)
权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动		-	354,383.36	-	-	-	-	354,383.36
2024年12月31日年末余额		<u>1,247,621,058.00</u>	<u>2,253,458,866.89</u>	<u>(35,935,687.59)</u>	<u>4,561,189.08</u>	<u>35,332,565.28</u>	<u>230,695,166.89</u>	<u>3,735,733,158.55</u>

有研半导体硅材料股份公司

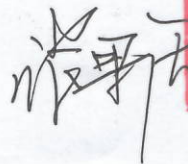

2025年度公司股东权益变动表(续)

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

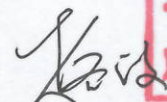

项目	附注	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2024年12月31日年末余额		1,247,621,058.00	2,253,458,866.89	(35,935,687.59)	4,561,189.08	35,332,565.28	230,695,166.89	3,735,733,158.55
其他-处置子公司	十六(3)	-	16,385.87	-	-	-	(1,163,416.45)	(1,147,030.58)
2025年1月1日年初余额		1,247,621,058.00	2,253,475,252.76	(35,935,687.59)	4,561,189.08	35,332,565.28	229,531,750.44	3,734,586,127.97
2025年度增减变动额								
综合收益总额								
净利润		-	-	-	-	-	46,908,364.86	46,908,364.86
股东投入和减少资本								
股东投入资本	四(29)	2,680,800.00	32,482,538.12	-	-	-	-	35,163,338.12
股份支付计入股东权益的金额		-	8,086,869.17	-	-	-	-	8,086,869.17
利润分配								
提取盈余公积	四(32)	-	-	-	-	4,690,836.49	(4,690,836.49)	-
对股东的分配	四(33)	-	-	-	-	-	(74,643,943.32)	(74,643,943.32)
专项储备								
本年提取		-	-	-	929,558.74	-	-	929,558.74
本年使用		-	-	-	(774,798.59)	-	-	(774,798.59)
权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动	四(11)	-	144,701.54	-	-	-	-	144,701.54
2025年12月31日年末余额		1,250,301,858.00	2,294,189,361.59	(35,935,687.59)	4,715,949.23	40,023,401.77	197,105,335.49	3,750,400,218.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 张果虎

主管会计工作的负责人: 杨波

会计机构负责人: 李文彬

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 一 公司基本情况

有研半导体硅材料股份公司(原名：“国泰半导体材料有限公司”、“有研半导体材料有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”)系经北京市对外经济贸易委员会出具的京经贸资字 [2001]355 号《关于中外合资企业国泰半导体材料有限公司合同、章程及董事会组成的批复》及北京市人民政府核发的《中华及北京市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(批准号：外经贸京字[2001]0489 号)批准，由有研新材料股份有限公司(以下简称“有研新材”)和香港凯晖控股有限公司(以下简称“凯晖控股”)共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 18,000 万元。于 2001 年 6 月 21 日，本公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：企合京总字第 015962 号)。

于 2003 年 5 月 29 日，经公司第一届董事会第二十三次会议决议通过，本公司注册资本由 18,000 万元变更为 20,700 万元，新增注册资本全部由有研新材以货币形式投入。公司于 2003 年 10 月 23 日取得由北京市工商行政管理局换发的注册号为企合京总字第 015962 号的营业执照。本次增资完成后有研新材持有本公司 69.5652%的股权，凯晖控股持有本公司 30.4348%的股权。

于 2004 年 12 月 5 日，经公司董事会决议通过，原股东凯晖控股将其持有的本公司 30.4348%的股权转让至国晶微电子控股有限公司(以下简称“国晶微电子”)。公司于 2005 年 8 月 30 日在北京市工商行政管理局完成工商变更登记。本次转让完成后有研新材持有本公司 69.5652%的股权，国晶微电子持有本公司 30.4348%的股权。

于 2014 年 9 月 18 日，经公司第五届董事会第六十六次会议决议通过，有研新材及国晶微电子将其持有的本公司全部股权转让至中国有研科技集团有限公司(曾用名：“有研科技集团有限公司”、“北京有色金属研究总院”，以下简称“中国有研”)。该转让于 2014 年 11 月 18 日经过北京市顺义区商务委员会作出的《关于国泰半导体材料有限公司股权转让变更为内资企业的批复》批准，并于 2014 年 12 月 10 日在北京市工商行政管理局办理工商变更登记。本次转让完成后中国有研持有本公司 100%的股权。

于 2014 年 12 月 19 日，经公司股东决定，本公司注册资本由 20,700 万元变更为 85,161 万元，新增注册资本全数由中国有研以货币形式投入。公司于 2014 年 12 月 23 日取得由北京市工商行政管理局换发的注册号为 110000410159624 的营业执照。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 一 公司基本情况(续)

于 2017 年 11 月 30 日，中国有研与株式会社 RS Technologies (以下简称“RS Technologies”)、福建仓元投资有限公司(以下简称“仓元投资”)签署《北京有研艾斯半导体科技有限公司合资合同》，约定三方共同出资设立北京有研艾斯半导体科技有限公司(以下简称“北京有研艾斯”)。其中，中国有研以其持有的本公司 100% 股权认缴北京有研艾斯注册资本 6,791.54 万美元，占北京有研艾斯注册资本的 49%；RS Technologies 以货币出资认缴北京有研艾斯注册资本 6,237.13 万美元，占北京有研艾斯注册资本的 45%；仓元投资以货币出资认缴北京有研艾斯注册资本 831.62 万美元，占北京有研艾斯注册资本的 6%。

于 2018 年 1 月 8 日，经中国有研第一届董事会第二次会议决议通过本公司改制方案，批准本公司由国有资本控股公司改制为非国有资本控股公司。

于 2018 年 2 月 1 日，经中国有研股东决定通过，将其持有的本公司 100% 股权出资至北京有研艾斯。本公司于 2018 年 2 月 7 日取得由北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91110000600090126J 的营业执照。本次变更完成后北京有研艾斯持有本公司 100% 股权。

于 2019 年 1 月 29 日，经公司股东决定，本公司注册资本由 85,161 万元变更为 130,161 万元，新增注册资本全数由中国有研以货币形式投入。公司于 2019 年 2 月 18 日取得由北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91110000600090126J 的营业执照。

于 2021 年 2 月 18 日，经公司股东决定，北京有研艾斯将其持有的本公司 25.60% 的股份转让给中国有研，23.51% 的股份转让给 RS Technologies，3.14% 的股份转让给仓元投资以及合计 5% 的股份转让给德州芯利咨询管理中心(有限合伙)等 6 个员工持股平台。本公司于 2021 年 2 月 25 日进行了工商变更登记。

于 2021 年 5 月 26 日，经公司第一次股东大会会议决议通过，本公司以截至 2021 年 1 月 31 日止的净资产 123,419.21 万元为基础，按照 1:0.7292 的比例折为 900,000,000 股，整体改制变更为股份公司。本公司于 2021 年 6 月 4 日取得由北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91110000600090126J 的营业执照。

于 2021 年 5 月 26 日，经公司第一届董事会第一次会议决议通过，本公司注册资本由 900,000,000 元增加至 1,060,477,900 元，新增注册资本部分由深圳诺河投资合伙企业(有限合伙)，中信证券投资有限公司和中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙) 3 名新增股东和原股东 RS Technologies 认缴。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 一 公司基本情况(续)

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2047 号文《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司于 2022 年 11 月 7 日以每股 9.91 元的价格向境内投资者首次公开发行人民币普通股 (A 股) 187,143,158 股，募集资金人民币 1,854,588,695.78 元，其中计入股本 187,143,158.00 元，扣除不含税发行费用 190,621,430.41 元后，剩余 1,476,824,107.37 元计入资本公积。本公司于 2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

于 2022 年 11 月 17 日，经公司第一届董事会第十次会议决议通过，本公司注册资本变更为 1,247,621,058.00 元。公司于 2022 年 12 月 29 日取得由北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91110000600090126J 的营业执照。

于 2025 年 12 月，本公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期第一次行权增加股份 2,680,800 股，增加股本人民币 2,680,800.00 元，并将行权款与股票面值的差额人民币 21,580,440.00 元计入资本公积(股本溢价)。公司于 2026 年 1 月 9 日取得由北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91110000600090126J 的营业执照。

于 2025 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 1,250,301,858.00 元，每股面值 1 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要开展的经营业务为生产、研制和销售重掺砷单晶(片)、区熔硅单晶(片)、石英坩埚；电子专用材料研发、制造和销售；提供相关技术开发、转让及咨询服务；货物进出口和技术进出口业务。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注五。

本财务报表由本公司董事会于 2026 年 3 月 25 日批准报出。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量(附注二(10))、存货的计价方法(附注二(11))、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销(附注二(13)、(15)、(27))、长期资产减值(附注二(17))、收入的确认和计量(附注二(24))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注二(29)。

### (1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

### (2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2025 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### (3) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (4) 重要性标准确定方法和选择依据

本集团结合自身所处的行业情况和生产经营特点，基于事项的性质和金额两方面综合判断相关财务信息的重要性。其中，根据该事项是否属于日常活动、是否显著影响财务状况、经营成果和现金流量等因素综合判断性质的重要性；根据该事项相关的金额及其占各项目金额、资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入和净利润等关键财务指标的比重综合判断金额的重要性。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (4) 重要性标准确定方法和选择依据(续)

项目	重要性标准
重要的账龄超过 1 年的预付款项、合同负债、应付账款及其他应付款	相关款项期末账面余额占资产总额 1%以上
重要的在建工程	单个在建工程项目的预算金额大于 5,000 万元
重要的投资活动现金流项目	单项投资现金流金额超过占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10%以上且绝对金额大于 5,000 万元
存在重要少数股东权益的子公司	其少数股东权益余额占合并股东权益余额 5%以上且金额大于 5,000 万元
重要的合营企业或联营企业	权益法核算的长期股权投资损益绝对金额占合并净利润金额 10%以上且绝对金额大于 2,000 万元

### (5) 记账本位币

本公司及子公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

### (6) 企业合并

#### (a) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (b) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (7) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。当相关子公司被处置并丧失控制权时，上述内部交易损益得以实现，本集团相应调整处置子公司的当期损益。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (7) 合并财务报表的编制方法(续)

本集团自子公司的少数股东处取得少数股东持有的对该子公司部分少数股权，在合并财务报表中，该子公司的资产、负债仍以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积的金额不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，本集团在合并财务报表中，对于剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，但由于原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动，以及原子公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的累计公允价值变动而产生的其他综合收益直接转入留存收益。

### (8) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (9) 外币折算

#### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 二 主要会计政策和会计估计(续)

#### (9) 外币折算(续)

##### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### (10) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

##### (a) 金融资产

###### (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：**(1)**以摊余成本计量的金融资产；**(2)**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；**(3)**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (10) 金融工具(续)

#### (a) 金融资产(续)

##### (i) 分类和计量(续)

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

#### 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 二 主要会计政策和会计估计(续)

#### (10) 金融工具(续)

##### (a) 金融资产(续)

##### (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、应收款项融资和应收租赁款外，于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 二 主要会计政策和会计估计(续)

#### (10) 金融工具(续)

##### (a) 金融资产(续)

##### (ii) 减值(续)

按照单项计算预期信用损失的各类金融资产，其信用风险特征与该类中的其他金融资产显著不同。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收票据	银行承兑汇票
应收款项融资	银行承兑汇票
应收账款组合一	关联方客户，以初始确认时点作为账龄的起算时点
应收账款组合二	第三方客户，以初始确认时点作为账龄的起算时点
其他应收款组合一	押金、保证金及备用金等信用风险较低的应收款项
其他应收款组合二	除以上组合以外的应收款项

对于划分为组合的应收账款、应收租赁款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

##### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**(1)**收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**(2)**该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；**(3)**该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 二 主要会计政策和会计估计(续)

#### (10) 金融工具(续)

##### (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债均为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款及其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

##### (c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (11) 存货

##### (a) 分类

存货包括原材料、在产品、半成品、库存商品和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低计量。

##### (b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品、半成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 二 主要会计政策和会计估计(续)

#### (11) 存货(续)

##### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。在同一地区生产和销售且具有相同或类似最终用途的存货，本集团合并计提存货跌价准备。本集团根据保管状态及预计未来销售情况等因素计提存货跌价准备。

##### (d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

##### (e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，采用一次转销法进行摊销。

#### (12) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

##### (a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

##### (b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 二 主要会计政策和会计估计(续)

#### (12) 长期股权投资(续)

##### (b) 后续计量及损益确认方法(续)

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认本公司财务报表的投资损益。在编制合并财务报表时，对于本集团向被投资单位投出或出售资产的顺流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在本公司财务报表抵销的基础上，对有关未实现的收入和成本或资产处置损益等中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整投资收益；对于被投资单位向本集团投出或出售资产的逆流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在本公司财务报表抵销的基础上，对有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

##### (c) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

##### (d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(17))。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (13) 固定资产

#### (a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备以及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### (b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10 - 45 年	5%	2.1%至 9.5%
机器设备	5 - 25 年	0%至 5%	3.8%至 20.0%
运输工具	5 - 10 年	5%	9.5%至 19.0%
办公设备及其他	3 - 10 年	5%	9.5%至 31.7%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### (c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(17))。

#### (d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (14) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(17))。

### (15) 无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权和软件，以成本计量。

#### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。

#### (b) 专利权和软件

专利权和软件均以实际成本计量，其中专利权按预计使用年限 10 年平均摊销，软件按预计使用年限 5 年平均摊销。

#### (c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### (d) 研究与开发

本集团的研究开发支出主要包括本集团实施研究开发活动而耗用的材料、研发部门职工薪酬、研发使用的设备及软件等资产的折旧摊销、研发测试、研发技术服务费及授权许可费等支出。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺或产品最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 二 主要会计政策和会计估计(续)

#### (15) 无形资产(续)

##### (d) 研究与开发(续)

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

##### (e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(17))。

#### (16) 长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### (17) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (18) 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 二 主要会计政策和会计估计(续)

#### (18) 职工薪酬(续)

##### (a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

##### (b) 离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

##### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### (c) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

#### (19) 安全生产费

本集团按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (20) 股利分配

现金股利于股东会批准的当期，确认为负债。

### (21) 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

### (22) 股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。于报告期内，本集团实施的股票期权计划作为以权益结算的股份支付进行核算。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入当期损益，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (22) 股份支付(续)

本集团修改股份支付计划条款时，如果修改增加了所授予权益工具的公允价值，本集团根据修改前后的权益工具在修改日公允价值之间的差额相应确认取得服务的增加。如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团按照修改后的可行权条件核算；如果本集团以不利于职工的方式修改可行权条件，核算时不予以考虑，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。如果本集团取消了所授予的权益工具，则于取消日作为加速行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

如果本集团需要按事先约定的回购价格回购未解锁而失效或作废的限制性股票，本集团按照股票的数量以及相应的回购价格确认负债及库存股。

### (23) 回购股份

本集团回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。发行、回购、出售或注销自身权益工具，均不确认任何利得或损失。

### (24) 收入

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

#### (a) 销售自产产品

本集团生产半导体抛光片、刻蚀设备用硅材料等产品并销售予国内外客户。

对于国内销售收入，本集团按照合同约定将产品运至约定的交货地点，由购买方接受并签收时确认收入或者按照合同约定由购买方自提，于购买方提货时确认收入；

对于国外销售收入，根据 EXW、FOB 和 CIF 等相关贸易条款，在购买方取得产品控制权时确认收入。

#### (b) 提供劳务

本集团对外提供受托加工服务以及技术服务等劳务服务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 二 主要会计政策和会计估计(续)

#### (24) 收入(续)

##### (b) 提供劳务(续)

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注二(10))；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

##### (c) 销售原材料、配件和废料及外购商品

本集团对外销售原材料、配件和废料及外购商品，于相关商品的控制权转移给购买方时，按预期有权收取对价的金额确认收入。

#### (25) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (26) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### (27) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

#### 本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

## 有研半导体硅材料股份公司

### 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (27) 租赁(续)

#### 本集团作为承租人(续)

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### 本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

### (a) 经营租赁

本集团经营租出自有的房屋建筑物时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (28) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：**(1)**该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**(2)**本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**(3)**本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团为一个经营分部。

### (29) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

#### (a) 采用会计政策的关键判断

##### (i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 二 主要会计政策和会计估计(续)

#### (29) 重要会计估计和判断(续)

##### (a) 采用会计政策的关键判断(续)

##### (ii) 信用风险显著增加和已发生信用减值的判断

本集团在区分金融工具所处的不同阶段时，对信用风险显著增加和已发生信用减值的判断如下：

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降从而将影响违约概率等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

##### (b) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

##### (i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率或基于账龄矩阵确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

##### (ii) 存货跌价准备

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。在计算可变现净值的过程中，本集团根据可获取的市场信息或者已经签订的销售订单确定产品的估计市场价格，并按照历史经验及数据确定需要经过加工的存货至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用及相关税费。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 二 主要会计政策和会计估计(续)

#### (29) 重要会计估计和判断(续)

##### (b) 重要会计估计及其关键假设(续)

##### (iii) 长期资产减值准备的会计估计

本集团的长期资产主要包括长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产及长期待摊费用。

本集团对存在减值迹象的长期资产进行减值测试时，当减值测试结果表明相关资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

当本集团采用预计未来现金流量的现值确定可收回金额时，由于相关地区所处的经济环境的发展存在不确定性，预计未来现金流量的现值计算中所采用的收入增长率、毛利率及税前折现率亦存在不确定性。

如果管理层对相关资产组未来现金流量计算中采用的收入增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的收入增长率，本集团可能需对相关资产增加计提减值准备。

如果管理层对相关资产组未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团可能需对相关资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行修订，修订后的税前折现率高于目前采用的税前折现率，本集团可能需对相关资产增加计提减值准备。

如果实际收入增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的相关资产减值损失。

##### (iv) 所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

## 有研半导体硅材料股份公司

### 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (29) 重要会计估计和判断(续)

#### (b) 重要会计估计及其关键假设(续)

#### (iv) 所得税和递延所得税(续)

如附注三(2)所述，本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照25%的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

#### (v) 股份支付

本集团采用期权定价模型确定股票期权于授予日的公允价值。采用定价模型要求本集团对使用的主要参数，包括标的股票市场价格、预期期权期限、预期波动率、无风险收益率等，作出适当的估计。

等待期的每个资产负债表日，本集团需对可行权期间因职工离职导致失效的股票期权数量以及股票期权授予方案中约定的业绩行权条件在未来期间能否实现作出适当的估计，并据以确定当期应确认的股份支付成本及费用。

### (30) 重要会计政策变更

财政部于 2025 年发布了若干《企业会计准则实施问答》(以下简称“实施问答”)，本集团一贯采用的会计政策与上述实施问答的原则一致，该实施问答对本集团及本公司的财务报表没有重大影响。

此外，财政部于 2025 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 19 号》，并自 2026 年 1 月 1 日起施行。本集团及本公司预计执行该解释对本集团及本公司财务报表无重大影响。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 三 税项

#### (1) 本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税(a)	应纳税所得额	12.5%及 25%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、9%及 13%
城市维护建设税	缴纳和免抵的增值税额	7%
教育费附加	缴纳和免抵的增值税额	3%
地方教育费附加	缴纳和免抵的增值税额	2%

(a) 根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的公告》(财税[2023] 37 号)等相关规定，本集团在 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日的期间内，新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

#### (2) 税收优惠

(a) 于 2024 年 12 月，本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司(以下简称“山东有研半导体”)取得山东省科学技术厅、山东省财政厅及国家税务总局山东省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202437002377)，该证书的有效期为 3 年。此外，山东有研半导体还享受国家鼓励的集成电路材料企业两免三减半优惠，2021 年至 2022 年免征企业所得税，2023 年至 2025 年减半按 12.5%征收企业所得税。

(b) 根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39 号)以及财政部和税务总局颁布的《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》(财政部税务总局公告[2023] 17 号)的相关规定，本公司及子公司山东有研半导体作为集成电路企业，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减增值税应纳税额。

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
银行存款	618,291,520.43	905,848,935.90
其他货币资金(a)	48,576,552.29	124,044,444.50
	<u>666,868,072.72</u>	<u>1,029,893,380.40</u>
其中：存放在境外的款项	-	-

- (a) 于 2025 年 12 月 31 日，其他货币资金 48,576,552.29 元(2024 年 12 月 31 日：124,044,444.50 元)为本集团向银行申请开具银行承兑汇票、信用证及保函所存入的保证金存款。

(2) 交易性金融资产

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
银行理财产品	<u>1,910,302,191.79</u>	<u>1,910,071,561.64</u>

(3) 应收票据

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	68,497,962.62	74,479,689.41
减：坏账准备	-	-
	<u>68,497,962.62</u>	<u>74,479,689.41</u>

- (a) 于 2025 年 12 月 31 日，本集团无列示于应收票据的已质押的应收票据。
- (b) 于 2025 年 12 月 31 日，本集团列示于应收票据的已背书但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	-	<u>33,857,482.80</u>

(c) 坏账准备

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似，无单项计提减值准备的银行承兑汇票。

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(3) 应收票据(续)

(c) 坏账准备(续)

(i) 组合计提坏账准备的应收票据分析如下：

组合 — 银行承兑汇票：

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期计量的应收票据预期信用损失金额不重大，故未计提相关坏账准备。本集团认为所持该组合内的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(ii) 本年度无计提或转回的坏账准备(2024 年度：无)。

(iii) 本年度无实际核销的应收票据(2024 年度：无)。

(4) 应收账款

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应收账款	296,227,528.55	212,580,139.18
减：坏账准备	(4,443,412.92)	(3,467,719.75)
	<u>291,784,115.63</u>	<u>209,112,419.43</u>

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
180 天以内	296,227,528.55	204,608,206.06
181 - 365 天	-	7,971,933.12
	<u>296,227,528.55</u>	<u>212,580,139.18</u>

(b) 于 2025 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款 余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	<u>188,428,437.14</u>	<u>(2,826,426.56)</u>	<u>63.61%</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(4) 应收账款(续)

(c) 本集团 2025 年度无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2024 年度：无)。

(d) 坏账准备

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本集团无单项计提坏账准备的应收账款。

(i) 组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 — 关联方客户组合

	2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
180 天以内	<u>20,729,867.29</u>	1.50%	<u>(310,948.01)</u>	<u>9,063,187.91</u>	1.50%	<u>(135,947.81)</u>

组合 — 第三方客户组合

	2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
180 天以内	275,497,661.26	1.50%	(4,132,464.91)	195,545,018.15	1.50%	(2,933,175.28)
181 - 365 天	-	-	-	7,971,933.12	5.00%	(398,596.66)
	<u>275,497,661.26</u>		<u>(4,132,464.91)</u>	<u>203,516,951.27</u>		<u>(3,331,771.94)</u>

(ii) 本年度计提的坏账准备金额为 4,537,972.13 元(2024 年度：3,467,719.75 元)，本年度收回或转回的坏账准备金额为 3,467,719.75 元(2024 年度：2,603,028.12 元)，本年度因处置子公司减少的坏账金额为 94,559.21 元(2024 年度：无)。

(iii) 本年度无实际核销的应收账款(2024年度：无)。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 四 合并财务报表项目附注(续)

#### (5) 应收款项融资

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	<u>90,341,764.46</u>	<u>129,563,009.25</u>

根据汇票管理规定，本集团及所属子公司持有的计划背书的银行承兑汇票，依据银行信用评级等来判断银行承兑汇票是否在背书时满足终止确认条件。对于背书时满足终止确认条件的银行承兑汇票，其管理业务模式实质为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，将其分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资；对于背书时不满足终止确认条件的银行承兑汇票，将其分类为以摊余成本计量的金融资产，列示为应收票据。2025 年度本集团背书银行承兑汇票且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移给其他方，相应终止确认的银行承兑汇票账面价值为 328,670,938.51 元(2024 年度：288,994,824.74 元)。

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似，无单项计提减值准备的银行承兑汇票。

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期计量的应收款项融资预期信用损失金额不重大，故未计提相关坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于 2025 年 12 月 31 日，除附注四(3)(b)外，本集团已背书但尚未到期的银行承兑汇票为 100,785,232.68 元，均已终止确认。

2025 年度本集团不存在重要的应收款项融资的核销情况(2024 年度：无)。

#### (6) 预付款项

##### (a) 预付款项账龄分析如下：

	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	<u>52,153,065.51</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,130,945.05</u>	<u>100.00%</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(6) 预付款项(续)

(b) 于 2025 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	<u>51,920,722.83</u>	<u>99.55%</u>

(7) 其他应收款

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应收处置子公司款项(附注五(1))	4,884,911.00	-
应收押金、保证金及备用金	142,440.24	97,766.00
应收代垫款	142,193.29	386,374.95
其他	137,821.97	142,787.64
	<u>5,307,366.50</u>	<u>626,928.59</u>
减：坏账准备	(146,444.80)	(139,913.47)
	<u>5,160,921.70</u>	<u>487,015.12</u>

本集团不存在因资金集中管理而将款项归集于其他方并列报于其他应收款的情况。

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
180 天以内	5,135,548.38	189,881.14
181 - 365 天	7,604.54	94,219.02
一到二年	127,213.58	283,816.88
二年以上	37,000.00	59,011.55
	<u>5,307,366.50</u>	<u>626,928.59</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(7) 其他应收款(续)

(b) 损失准备及其账面余额变动表

	未来 12 个月内预期信用损失 (组合)		第一阶段 未来 12 个月内预期信用损失 (单项)			合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	小计	坏账准备
					坏账准备	
2024 年 12 月 31 日	626,928.59	(139,913.47)	-	-	(139,913.47)	(139,913.47)
本年新增的款项	15,489,193.86	(128,638.93)	-	-	(128,638.93)	(128,638.93)
本年减少的款项	(10,808,755.95)	122,107.60	-	-	122,107.60	122,107.60
其中：本年收回	(10,778,439.95)	113,012.80	-	-	113,012.80	113,012.80
处置子公司减少	(30,316.00)	9,094.80	-	-	9,094.80	9,094.80
2025 年 12 月 31 日	5,307,366.50	(146,444.80)	-	-	(146,444.80)	(146,444.80)

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本集团不存在重大的处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。处于第一阶段的其他应收款分析如下：

(i) 于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本集团无单项计提坏账准备的其他应收款。

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(7) 其他应收款(续)

(b) 损失准备及其账面余额变动表(续)

(ii) 于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备		账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例	金额	金额	计提比例
组合一：						
180 天以内	132,019.32	(1,980.28)	1.50%	28,450.00	(426.75)	1.50%
181 - 365 天	-	-	-	12,000.00	(600.00)	5.00%
一到二年	21,000.00	(6,300.00)	30.00%	74,316.00	(22,294.80)	30.00%
二年以上	37,000.00	(30,200.00)	81.62%	3,000.00	(2,400.00)	80.00%
组合二：						
180 天以内	5,003,529.06	(75,720.22)	1.50%	161,431.14	(2,421.47)	1.50%
181 - 365 天	7,604.54	(380.23)	5.00%	82,219.02	(4,110.95)	5.00%
一到二年	106,213.58	(31,864.07)	30.00%	209,500.88	(62,850.26)	30.00%
二年以上	-	-	-	56,011.55	(44,809.24)	80.00%
	<u>5,307,366.50</u>	<u>(146,444.80)</u>		<u>626,928.59</u>	<u>(139,913.47)</u>	

(c) 本年度计提的坏账准备金额为 128,638.93 元，收回的坏账准备金额为 113,012.80 元，因处置子公司减少的坏账准备金额为 9,094.80 元。

(d) 2025 年度本集团不存在重要的其他应收款的转回或核销情况(2024 年度：无)。

(e) 于 2025 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

	性质	余额	账龄	占其他应收款 余额总额比例	坏账准备
殷封封及其控制的 持股平台	处置子公司款项	4,884,911.00	180 天以内	92.04%	(73,273.67)
中国电子系统工程 第四建设有限公 司	代垫款	132,279.47	二年以内	2.49%	(28,428.63)
德州盛信投资开发 有限公司	押金和保证金	79,579.08	二年以内	1.50%	(23,663.69)
员工	代垫款	72,000.00	180 天以内	1.36%	(1,080.00)
员工	备用金	57,170.61	180 天以内	1.08%	(857.56)
		<u>5,225,940.16</u>		<u>98.47%</u>	<u>(127,303.55)</u>

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

### 2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

#### 四 合并财务报表项目附注(续)

##### (8) 存货

##### (a) 存货分类如下：

	2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	60,694,829.97	(569,078.75)	60,125,751.22	64,935,268.69	-	64,935,268.69
在产品	24,567,906.13	(755,856.72)	23,812,049.41	16,457,254.02	(155,029.98)	16,302,224.04
半成品	55,514,306.93	(4,677,850.89)	50,836,456.04	50,183,188.06	(4,351,432.08)	45,831,755.98
库存商品	89,850,954.69	(6,398,974.01)	83,451,980.68	84,241,930.27	(2,638,385.88)	81,603,544.39
委托加工物资	124,507.83	-	124,507.83	751,252.23	-	751,252.23
	<u>230,752,505.55</u>	<u>(12,401,760.37)</u>	<u>218,350,745.18</u>	<u>216,568,893.27</u>	<u>(7,144,847.94)</u>	<u>209,424,045.33</u>

##### (b) 存货跌价准备分析如下：

	2024 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年处置 子公司减少	2025 年 12 月 31 日
原材料	-	(620,658.20)	-	51,579.45	(569,078.75)
在产品	(155,029.98)	(603,280.86)	2,454.12	-	(755,856.72)
半成品	(4,351,432.08)	(353,095.65)	26,676.84	-	(4,677,850.89)
库存商品	(2,638,385.88)	(3,969,960.23)	-	209,372.10	(6,398,974.01)
	<u>(7,144,847.94)</u>	<u>(5,546,994.94)</u>	<u>29,130.96</u>	<u>260,951.55</u>	<u>(12,401,760.37)</u>

##### (c) 存货跌价准备情况如下：

	确定可变现净值的具体依据	本年转回 存货跌价准备的原因
原材料	主要以最终产品的市场价扣除相关费用后确定	—
库存商品	分不存在合同保证和存在不可撤销合同保证两部分，无合同保证的以最终产品的市场价扣除相关费用后确定产品的可变现净值，有合同保证以不可撤销的合同单价扣除相关费用后确定	—
在产品	主要以最终产品的市场价扣除相关费用后确定	完成生产对外销售
半成品	主要以最终产品的市场价扣除相关费用后确定	完成生产对外销售
委托加工物资	主要以最终产品的市场价扣除相关费用后确定	—

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(9) 其他流动资产

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
待抵扣及待认证进项税额	<u>7,767,319.59</u>	<u>9,040,232.63</u>

(10) 其他非流动金融资产

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
山东恒圣石墨科技有限公司 (“山东恒圣石墨”)	<u>30,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具核算。因本集团自资产负债表日起预期将持有该投资超过一年，故将其列示为其他非流动金融资产。

(11) 长期股权投资

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
联营企业 (a)	<u>686,711,374.61</u>	<u>350,511,948.72</u>
减：长期股权投资减值准备	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>686,711,374.61</u>	<u>350,511,948.72</u>

## 有研半导体硅材料股份公司

### 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

#### 四 合并财务报表项目附注(续)

##### (11) 长期股权投资(续)

##### (a) 联营企业

	2024 年 12 月 31 日	本年增减变动				2025 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	按权益法调整的净损失	其他权益变动		
山东有研艾斯半导体材料 有限公司 (“山东有研艾斯”)	347,955,148.81	380,000,000.00	-	(49,188,462.63)	132,688.43	678,899,374.61	-
山东尚泰新材料有限公司 (“山东尚泰”)(ii)	2,556,799.91	-	(1,899,324.18)	(657,475.73)	-	-	-
北京艾唯特科技有限公司 (“北京艾唯特”)(iii)	-	7,812,000.00	-	-	-	7,812,000.00	-
	<u>350,511,948.72</u>	<u>387,812,000.00</u>	<u>(1,899,324.18)</u>	<u>(49,845,938.36)</u>	<u>132,688.43</u>	<u>686,711,374.61</u>	<u>-</u>

- (i) 于 2025 年 1 月 2 日，本集团以现金向山东有研艾斯增资 380,000,000.00 元，增资后本集团对山东有研艾斯持股比例自 19.99% 上升至 28.11%。
- (ii) 于 2025 年 7 月 15 日，本集团将持有的 9% 山东尚泰的股权作价 5,400,000.00 元转让给山东恒圣石墨，确认处置收益 3,500,675.82 元(附注四(44))。
- (iii) 2025 年度，本集团转让其持有的北京艾唯特 49.48% 的股权，转让后，剩余股权比例为 30.00%。上述交易完成后，本集团不再拥有对北京艾唯特的控制权。本集团有权提名一名董事，参与或影响其财务和经营决策，对北京艾唯特具有重大影响，将其作为联营企业采用权益法核算(附注五(1))。

本集团在联营企业中的权益相关信息见附注六(2)。

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(12) 固定资产

	房屋及建筑物 自用/出租(i)	机器设备 自用	运输工具 自用	办公设备及其他 自用	合计
原价					
2024 年 12 月 31 日	684,288,150.02	1,177,773,000.89	2,740,839.09	5,434,078.69	1,870,236,068.69
本年购入	-	93,595.57	5,884.96	240,477.01	339,957.54
在建工程转入(附注四(13))	80,807,055.65	288,460,305.79	124,018.08	683,381.06	370,074,760.58
处置及报废	-	-	(486,620.69)	-	(486,620.69)
处置子公司减少	-	(1,355,656.01)	-	(253,546.00)	(1,609,202.01)
2025 年 12 月 31 日	765,095,205.67	1,464,971,246.24	2,384,121.44	6,104,390.76	2,238,554,964.11
累计折旧					
2024 年 12 月 31 日	(103,439,774.67)	(602,774,755.26)	(2,345,953.33)	(2,844,952.25)	(711,405,435.51)
计提	(16,209,684.96)	(75,200,751.47)	(162,219.26)	(1,056,613.75)	(92,629,269.44)
处置及报废	-	-	462,289.66	-	462,289.66
处置子公司减少	-	196,497.65	-	68,546.14	265,043.79
2025 年 12 月 31 日	(119,649,459.63)	(677,779,009.08)	(2,045,882.93)	(3,833,019.86)	(803,307,371.50)
减值准备					
2024 年 12 月 31 日	-	(131,511,330.51)	(5,792.95)	-	(131,517,123.46)
处置及报废	-	-	-	-	-
2025 年 12 月 31 日	-	(131,511,330.51)	(5,792.95)	-	(131,517,123.46)
账面价值					
2025 年 12 月 31 日	645,445,746.04	655,680,906.65	332,445.56	2,271,370.90	1,303,730,469.15
2024 年 12 月 31 日	580,848,375.35	443,486,915.12	389,092.81	2,589,126.44	1,027,313,509.72

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(12) 固定资产(续)

- (i) 于 2025 年度，本集团将总面积为 71,876.69 平方米的自有房屋建筑物中的 2,575.22 平方米出租给关联方山东有研艾斯用作生产活动(2024 年度：将总面积 56,830.25 平方米中的 6,691.52 平方米)，剩余部分为本集团自用。由于出租和自用部分均不能单独出售，本集团未将出租部分确认为投资性房地产，仍作为固定资产核算。
- (ii) 2025 年度固定资产计提的折旧金额为 92,629,269.44 元(2024 年度：81,947,095.31 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 79,188,979.20 元、21,074.27 元、687,436.49 元及 12,731,779.48 元(2024 年度：70,331,334.94 元、19,213.78 元、690,622.55 元及 10,905,924.04 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 370,074,760.58 元(2024 年度：95,386,312.38 元)。

本集团作为出租人签订的房屋建筑物的租赁合同未设置余值担保条款。

(13) 在建工程

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
在建工程(a)	60,853,016.17	246,835,396.49
减：在建工程减值准备	-	-
	<u>60,853,016.17</u>	<u>246,835,396.49</u>

(a) 在建工程

	2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
集成电路用大尺寸硅材料规模化生产项目	54,142,135.29	-	54,142,135.29	243,077,751.70	-	243,077,751.70
其他	6,710,880.88	-	6,710,880.88	3,757,644.79	-	3,757,644.79
	<u>60,853,016.17</u>	<u>-</u>	<u>60,853,016.17</u>	<u>246,835,396.49</u>	<u>-</u>	<u>246,835,396.49</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(13) 在建工程(续)

(a) 在建工程(续)

重大在建工程项目变动

工程名称	预算数	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入 固定资产 (附注四(12))	本年转入 长期待摊费用 (附注四(17))	2025 年 12 月 31 日	工程投入占 预算的比例	工程 进度	资金来源
集成电路用大尺寸硅材料规模化生产项目(i)	2,500,000,000.00	243,077,751.70	167,876,063.40	(348,245,574.03)	(8,566,105.78)	54,142,135.29	76.53%	建设中	募集资金 /自筹
其他	—	<u>3,757,644.79</u>	<u>24,782,422.64</u>	<u>(21,829,186.55)</u>	<u>-</u>	<u>6,710,880.88</u>	—	建设中	募集资金 /自筹
		<u>246,835,396.49</u>	<u>192,658,486.04</u>	<u>(370,074,760.58)</u>	<u>(8,566,105.78)</u>	<u>60,853,016.17</u>			

(i) 2025 年度，本集团集成电路用大尺寸硅材料规模化生产项目中总金额为 348,245,574.03 元的房屋、设备及工具，经安装调试验收后达到预定可使用状态，相应转入固定资产。

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(14) 使用权资产

房屋及建筑物

原价

2024 年 12 月 31 日	11,734,131.18
本年增加	
新增租赁合同	2,927,960.01
本年减少	
处置子公司减少	(567,818.02)
2025 年 12 月 31 日	14,094,273.17

累计折旧

2024 年 12 月 31 日	(4,880,675.50)
本年增加	
计提	(4,303,763.60)
本年减少	
处置子公司减少	388,748.24
2025 年 12 月 31 日	(8,795,690.86)

减值准备

2024 年 12 月 31 日	-
本年计提	-
本年减少	-
2025 年 12 月 31 日	-

账面价值

2025 年 12 月 31 日	5,298,582.31
2024 年 12 月 31 日	6,853,455.68

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(15) 无形资产

	土地使用权	专利权	软件	合计
原价				
2024 年 12 月 31 日	86,216,000.00	-	8,431,947.28	94,647,947.28
本年增加				
购置	-	20,754.72	2,996,781.78	3,017,536.50
本年减少				
处置子公司减少	-	-	(125,342.29)	(125,342.29)
2025 年 12 月 31 日	86,216,000.00	20,754.72	11,303,386.77	97,540,141.49

累计摊销

2024 年 12 月 31 日	(9,947,999.85)	-	(3,949,799.56)	(13,897,799.41)
本年增加				
计提	(1,730,086.92)	(172.96)	(1,551,547.04)	(3,281,806.92)
本年减少				
处置子公司减少	-	-	15,824.76	15,824.76
2025 年 12 月 31 日	(11,678,086.77)	(172.96)	(5,485,521.84)	(17,163,781.57)

减值准备

2024 年 12 月 31 日	-	-	-	-
本年增加	-	-	-	-
本年减少	-	-	-	-
2025 年 12 月 31 日	-	-	-	-

账面价值

2025 年 12 月 31 日	74,537,913.23	20,581.76	5,817,864.93	80,376,359.92
2024 年 12 月 31 日	76,268,000.15	-	4,482,147.72	80,750,147.87

2025年度无形资产的摊销金额为3,281,806.92元(2024年度：3,017,201.93元)。

于 2025 年 12 月 31 日，本集团不存在尚未办妥的土地使用权证(2024 年 12 月 31 日：无)。

于 2025 年 12 月 31 日，本集团无内部研发形成的无形资产(2024 年 12 月 31 日：无)。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 四 合并财务报表项目附注(续)

#### (16) 研究开发支出

2025 年度，本集团研究开发支出共计 92,414,261.56 元(2024 年度：78,280,741.45 元)，由于研究开发项目尚处于研究设计阶段，预期经济利益实现的不确定性较大，故本集团将当期发生的研究开发支出全部予以费用化。本集团 2025 年度及 2024 年度研究开发活动的总支出按性质列示参见附注四(38)。

#### (17) 长期待摊费用

	2024 年 12 月 31 日	本年在建 工程转入 (附注四(13))	本年摊销	处置子公司 减少	2025 年 12 月 31 日
使用权资 产改良	5,624,403.02	-	(2,007,292.92)	(2,724,697.19)	892,412.91
设备更新 改造	-	8,566,105.78	(212,665.65)	-	8,353,440.13
	<u>5,624,403.02</u>	<u>8,566,105.78</u>	<u>(2,219,958.57)</u>	<u>(2,724,697.19)</u>	<u>9,245,853.04</u>

#### (18) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### (a) 未经抵销的递延所得税资产

	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性 差异及可抵扣 亏损	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异及可抵扣 亏损	递延所得税 资产
存货跌价准备	12,401,760.37	1,959,600.47	7,144,847.94	949,783.04
股份支付	10,515,988.00	2,575,874.00	3,204,636.84	789,327.00
固定资产减值准备及 折旧差异	7,910,158.47	1,977,539.62	6,808,020.86	1,952,021.50
抵销内部未实现利润	6,236,597.91	935,489.69	3,199,408.98	399,926.12
租赁负债	5,518,901.43	1,367,235.60	6,977,464.33	1,744,366.08
坏账准备	4,589,847.34	732,896.07	3,607,633.22	523,499.51
无形资产折旧年限差异	1,020,000.08	153,000.02	680,000.08	85,000.01
征税政府补助	147,163.21	22,074.48	5,508,938.63	688,617.33
可抵扣亏损	-	-	872,569.49	218,142.36
	<u>48,340,416.81</u>	<u>9,723,709.95</u>	<u>38,003,520.37</u>	<u>7,350,682.95</u>
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年) 转回的金额	32,972,240.78	6,018,850.02	23,859,412.45	4,106,605.39
预计于 1 年后转回的 金额	<u>15,368,176.03</u>	<u>3,704,859.93</u>	<u>14,144,107.92</u>	<u>3,244,077.56</u>
	<u>48,340,416.81</u>	<u>9,723,709.95</u>	<u>38,003,520.37</u>	<u>7,350,682.95</u>

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 四 合并财务报表项目附注(续)

#### (18) 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

##### (b) 未经抵销的递延所得税负债

	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
固定资产折旧差异	14,299,320.68	2,144,898.10	-	-
使用权资产	5,298,582.31	1,312,350.64	6,853,455.68	1,713,363.92
公允价值变动	302,191.79	55,054.80	71,561.64	11,941.72
	<u>19,900,094.78</u>	<u>3,512,303.54</u>	<u>6,925,017.32</u>	<u>1,725,305.64</u>
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年) 转回的金额	5,686,171.30	1,141,809.58	3,954,369.14	982,643.59
预计于 1 年后转回的 金额	<u>14,213,923.48</u>	<u>2,370,493.96</u>	<u>2,970,648.18</u>	<u>742,662.05</u>
	<u>19,900,094.78</u>	<u>3,512,303.54</u>	<u>6,925,017.32</u>	<u>1,725,305.64</u>

##### (c) 本集团未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下：

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	10.38	-
可抵扣亏损	610,623.32	2,052,992.64
	<u>610,633.70</u>	<u>2,052,992.64</u>

##### (d) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
2025 年	-	597,610.09
2026 年	-	1,051,173.23
2028 年	-	49,148.48
2029 年	-	355,060.84
2030 年	610,623.32	-
	<u>610,623.32</u>	<u>2,052,992.64</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(18) 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(e) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	互抵金额	抵销后余额	互抵金额	抵销后余额
递延所得税资产	(3,476,474.14)	6,247,235.81	(1,725,305.64)	5,625,377.31
递延所得税负债	3,476,474.14	35,829.40	1,725,305.64	-

(19) 其他非流动资产

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
预付设备款	<u>770,281.80</u>	<u>26,051,820.49</u>

(20) 资产减值及损失准备

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2025 年 12 月 31 日
			转回	处置子公司	
应收账款坏账准备	3,467,719.75	4,537,972.13	(3,467,719.75)	(94,559.21)	4,443,412.92
其中：单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
组合计提坏账准备	3,467,719.75	4,537,972.13	(3,467,719.75)	(94,559.21)	4,443,412.92
其他应收款坏账准备	139,913.47	128,638.93	(113,012.80)	(9,094.80)	146,444.80
小计	<u>3,607,633.22</u>	<u>4,666,611.06</u>	<u>(3,580,732.55)</u>	<u>(103,654.01)</u>	<u>4,589,857.72</u>
存货跌价准备	7,144,847.94	5,546,994.94	(29,130.96)	(260,951.55)	12,401,760.37
固定资产减值准备	131,517,123.46	-	-	-	131,517,123.46
小计	<u>138,661,971.40</u>	<u>5,546,994.94</u>	<u>(29,130.96)</u>	<u>(260,951.55)</u>	<u>143,918,883.83</u>
	<u>142,269,604.62</u>	<u>10,213,606.00</u>	<u>(3,609,863.51)</u>	<u>(364,605.56)</u>	<u>148,508,741.55</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(20) 资产减值及损失准备(续)

	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2024 年 12 月 31 日
			转回	核销/转销	
应收账款坏账准备	2,603,028.12	3,467,719.75	(2,603,028.12)	-	3,467,719.75
其中：单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
组合计提坏账准备	2,603,028.12	3,467,719.75	(2,603,028.12)	-	3,467,719.75
其他应收款坏账准备	65,185.45	112,754.47	(38,026.45)	-	139,913.47
小计	2,668,213.57	3,580,474.22	(2,641,054.57)	-	3,607,633.22
存货跌价准备	9,782,339.50	-	(2,637,491.56)	-	7,144,847.94
固定资产减值准备	167,249,563.65	-	-	(35,732,440.19)	131,517,123.46
小计	177,031,903.15	-	(2,637,491.56)	(35,732,440.19)	138,661,971.40
	179,700,116.72	3,580,474.22	(5,278,546.13)	(35,732,440.19)	142,269,604.62

(21) 应付票据

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	46,555,914.88	115,721,960.05

于 2025 年 12 月 31 日，本集团不存在已到期未支付的应付票据 (2024 年 12 月 31 日：无)。

(22) 应付账款

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付材料款	130,249,348.26	106,529,198.31
其他	10,005,199.66	8,454,872.59
	140,254,547.92	114,984,070.90

(a) 于 2025 年 12 月 31 日，本集团无单项金额重大的账龄超过一年的应付账款 (2024 年 12 月 31 日：无)。

(b) 于 2025 年 12 月 31 日，本集团无涉及供应商融资安排的应付账款 (2024 年 12 月 31 日：无)。

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(23) 应付职工薪酬

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付短期薪酬(a)	36,793,208.77	36,389,967.45
应付设定提存计划(b)	666,060.27	649,588.95
应付辞退福利(c)	-	-
	<u>37,459,269.04</u>	<u>37,039,556.40</u>

(a) 短期薪酬

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	17,279,895.30	114,692,738.65	(115,820,761.95)	16,151,872.00
职工福利费	2,005,902.20	6,659,225.09	(6,697,291.09)	1,967,836.20
社会保险费	427,153.44	9,720,840.55	(9,738,266.02)	409,727.97
其中：医疗保险费	385,815.99	8,862,653.13	(8,852,869.83)	395,599.29
工伤保险费	41,337.45	490,359.12	(517,567.89)	14,128.68
补充医疗保险	-	367,828.30	(367,828.30)	-
住房公积金	-	10,919,188.35	(10,919,188.35)	-
工会经费和职工教育经费	16,677,016.51	3,937,938.36	(2,351,182.27)	18,263,772.60
	<u>36,389,967.45</u>	<u>145,929,931.00</u>	<u>(145,526,689.68)</u>	<u>36,793,208.77</u>

(b) 设定提存计划

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
基本养老保险	629,903.68	16,040,089.08	(16,024,116.76)	645,876.00
失业保险费	19,685.27	606,873.09	(606,374.09)	20,184.27
企业年金	-	3,697,857.78	(3,697,857.78)	-
	<u>649,588.95</u>	<u>20,344,819.95</u>	<u>(20,328,348.63)</u>	<u>666,060.27</u>

(c) 应付辞退福利

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
其他辞退福利(i)	<u>-</u>	<u>-</u>

(i) 2025 年度，本集团因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为 612,041.52 元 (2024 年度：2,026.57 元)。

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(24) 应交税费

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应交企业所得税	8,503,370.52	15,426,887.21
应交房产税	1,489,231.67	1,501,498.14
应交增值税	885,124.56	-
应交印花税	338,375.90	153,652.72
代扣代缴个人所得税	221,193.25	179,188.01
应交土地使用税	217,292.42	217,292.42
应交城市维护建设税	61,958.72	-
应交教育费附加	44,256.23	-
应交环保税	14,205.35	7,824.31
其他	-	7,038.18
	<u>11,775,008.62</u>	<u>17,493,380.99</u>

(25) 其他应付款

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付工程及设备款	92,217,216.85	76,222,992.06
应付服务费	9,148,567.57	5,278,631.83
应付代收及代扣款项	2,865,863.29	3,545,067.04
其他	2,820,845.25	2,202,003.20
	<u>107,052,492.96</u>	<u>87,248,694.13</u>

于 2025 年 12 月 31 日，本集团无单项金额重大的账龄超过一年的其他应付款(2024 年 12 月 31 日：无)。

(26) 一年内到期的非流动负债

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债 (附注四(27))	<u>4,153,084.43</u>	<u>4,858,613.87</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(27) 租赁负债

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
租赁负债	5,518,901.43	6,977,464.33
减：一年内到期的非流动负债 (附注四(26))	<u>(4,153,084.43)</u>	<u>(4,858,613.87)</u>
	<u>1,365,817.00</u>	<u>2,118,850.46</u>

(a) 于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本集团未纳入租赁负债，但将导致未来潜在现金流出的事项包括：

于 2025 年 12 月 31 日，本集团简化处理的短期租赁合同的未来最低应支付租金为 388,699.41 元(2024 年 12 月 31 日：90,000.00 元)，为一年内支付。

(28) 递延收益

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
政府补助	<u>190,683,646.81</u>	<u>32,221,932.13</u>	<u>(86,833,344.34)</u>	<u>136,072,234.60</u>
	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年计入 其他收益 (附注四(43))	2025 年 12 月 31 日
与资产相关的政府补助	115,247,715.75	-	(8,496,553.19)	106,751,162.56
与收益相关的政府补助	<u>75,435,931.06</u>	<u>32,221,932.13</u>	<u>(78,336,791.15)</u>	<u>29,321,072.04</u>
	<u>190,683,646.81</u>	<u>32,221,932.13</u>	<u>(86,833,344.34)</u>	<u>136,072,234.60</u>

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 四 合并财务报表项目附注(续)

#### (29) 股本

	2024 年	本年增减变动		2025 年
	12 月 31 日	增发(附注一)	其他(i)	12 月 31 日
人民币普通股				
有限售条件的人				
人民币普通股	740,055,400.00	-	(740,055,400.00)	-
无限售条件的人				
人民币普通股	507,565,658.00	2,680,800.00	740,055,400.00	1,250,301,858.00
	<u>1,247,621,058.00</u>	<u>2,680,800.00</u>	<u>-</u>	<u>1,250,301,858.00</u>
		2023 年		2024 年
		12 月 31 日	本年增减变动(ii)	12 月 31 日
人民币普通股				
有限售条件的人民币普通股	1,066,532,390.00	(326,476,990.00)		740,055,400.00
无限售条件的人民币普通股	181,088,668.00	326,476,990.00		507,565,658.00
	<u>1,247,621,058.00</u>	<u>-</u>		<u>1,247,621,058.00</u>

- (i) 于 2025 年 11 月 10 日，本公司首次公开发行部分限售股解除限售上市流通(限售期为公司上市之日起 36 个月)，股份数量 740,055,400 股，占公司股本总数的比例为 59.32%。
- (ii) 于 2024 年 2 月 26 日，本公司网下配售限售股份解除限售上市流通(限售期为自取得公司的股份完成工商登记之日起 36 个月)，股份数量 275,422,500 股，占公司股本总数的比例为 22.08%。于 2024 年 6 月 24 日，本公司部分战略配售股份解禁上市流通(限售期为自取得公司的股份完成工商登记之日起 36 个月)，股份数量为 45,000,000 股，占公司股本总数的比例为 3.61%。于 2024 年 11 月 11 日，本公司部分战略配售股份解禁上市流通(限售期为自公司股票上市之日起 24 个月)，股份数量为 6,054,490 股，占公司股本总数的比例为 0.49%。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 四 合并财务报表项目附注(续)

#### (30) 资本公积

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
股本溢价(ii)	2,168,310,043.01	32,409,998.89	-	2,200,720,041.90
其他资本公积—				
权益法核算的被投 资单位除综合收 益和利润分配以 外的其他权益变 动	82,716,974.84	132,688.43	-	82,849,663.27
以权益结算的股份 支付(i)(ii)	<u>6,312,480.28</u>	<u>18,852,208.59</u>	<u>(10,829,558.89)</u>	<u>14,335,129.98</u>
	<u>2,257,339,498.13</u>	<u>51,394,895.91</u>	<u>(10,829,558.89)</u>	<u>2,297,904,835.15</u>
	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
股本溢价	2,168,261,515.18	48,527.83	-	2,168,310,043.01
其他资本公积—				
权益法核算的被投 资单位除综合收 益和利润分配以 外的其他权益变 动	82,362,591.48	354,383.36	-	82,716,974.84
以权益结算的股份 支付(i)	<u>-</u>	<u>6,312,480.28</u>	<u>-</u>	<u>6,312,480.28</u>
	<u>2,250,624,106.66</u>	<u>6,715,391.47</u>	<u>-</u>	<u>2,257,339,498.13</u>

(i) 根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》的相关规定，按照股票期权的等待期分期摊销作为以权益结算的股份支付换取的职工服务的支出。本年摊销 18,988,967.29 元计入当期损益，相应增加资本公积(其他资本公积) 18,852,208.59 元，相应增加少数股东权益 136,758.70 元(2024 年：摊销 6,355,213.36 元计入当期损益，相应增加资本公积(其他资本公积)6,312,480.28 元，相应增加少数股东权益 42,733.08 元)。

(ii) 如附注一所述，本公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已经达成，向符合行权条件的 92 名激励对象进行 2,680,800 份股票期权的归属，因此将其对应的资本公积(其他资本公积) 10,829,558.89 元转入资本公积(股本溢价)，将实际收到的行权款与股本面值的差额 21,580,440.00 元计入资本公积(股本溢价)，合计增加资本公积(股本溢价) 32,409,998.89 元。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

### 2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

#### 四 合并财务报表项目附注(续)

##### (31) 库存股

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
库存股(i)	<u>35,935,687.59</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>35,935,687.59</u>

- (i) 于 2024 年 3 月，本公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式首次回购公司股份，并披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。本公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 3,555,336 股，占公司总股本的比例为 0.28%，实际回购区间为 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 4 月 30 日，回购的最高价为 10.70 元/股，最低价为 8.50 元/股，回购均价为 10.11 元/股，已支付的回购股份总金额为 35,935,687.59 元。

##### (32) 盈余公积

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	<u>35,332,565.28</u>	<u>4,690,836.49</u>	<u>-</u>	<u>40,023,401.77</u>

	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	<u>25,250,365.27</u>	<u>10,082,200.01</u>	<u>-</u>	<u>35,332,565.28</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司 2025 年度按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,690,836.49 元 (2024 年度：按净利润的 10% 提取，共 10,082,200.01 元)。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 四 合并财务报表项目附注(续)

#### (33) 未分配利润

	2025 年度	2024 年度
年初未分配利润	828,644,971.51	618,264,075.33
加：本年归属于母公司股东的 净利润	209,280,637.60	232,903,753.41
减：提取法定盈余公积 (附注四(32))	(4,690,836.49)	(10,082,200.01)
应付普通股股利(i)	(74,643,943.32)	(12,440,657.22)
年末未分配利润	<u>958,590,829.30</u>	<u>828,644,971.51</u>

- (i) 根据 2025 年 4 月 25 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利每股人民币 0.06 元，按已发行股份 1,247,621,058 股计算，共计 74,857,263.48 元。扣除回购专用证券账户中股份数 3,555,336 股，本次实际参与分配的股本数为 1,244,065,722 股，共计派发现金股利 74,643,943.32 元。

#### (34) 营业收入和营业成本

	2025 年度	2024 年度
主营业务收入	981,106,108.47	932,809,623.65
其他业务收入	24,139,616.01	63,136,229.44
	<u>1,005,245,724.48</u>	<u>995,945,853.09</u>
	2025 年度	2024 年度
主营业务成本	612,886,857.10	580,554,824.07
其他业务成本	23,253,556.33	50,187,296.80
	<u>636,140,413.43</u>	<u>630,742,120.87</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(34) 营业收入和营业成本(续)

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2025 年度		2024 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售产品				
- 半导体硅抛				
光片	616,254,104.79	422,743,107.50	610,923,856.84	443,272,369.65
- 刻蚀设备用				
硅材料	298,935,168.52	142,807,953.94	288,545,527.47	113,886,787.18
- 其他	65,916,835.16	47,335,795.66	33,340,239.34	23,395,667.24
	<u>981,106,108.47</u>	<u>612,886,857.10</u>	<u>932,809,623.65</u>	<u>580,554,824.07</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2025 年度		2024 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售外购商品	5,034,184.71	5,481,221.29	29,231,504.59	22,831,649.26
技术服务及受				
托加工收入	14,743,962.77	14,075,827.18	19,107,609.49	17,919,424.37
销售原辅料及				
废料	2,342,164.08	1,892,307.61	9,797,999.53	5,278,915.10
租金收入(i)	426,456.12	387,526.68	1,908,324.12	1,256,118.48
其他	1,592,848.33	1,416,673.57	3,090,791.71	2,901,189.59
	<u>24,139,616.01</u>	<u>23,253,556.33</u>	<u>63,136,229.44</u>	<u>50,187,296.80</u>

(i) 本集团的租金收入来自于出租自有房屋及建筑物。

(c) 本集团主营业务收入均为在某一时点确认。

本集团其他业务收入中销售外购商品、销售原辅材料及废料收入于某一时点确认，技术服务及受托加工收入为在某一段时间内确认。

于 2025 年 12 月 31 日，本集团已签订合同但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入，预计将均于 2026 年度确认收入。

2025 年度，本集团不存在重大的合同变更或交易价格的调整。

(d) 2025 年度，本集团无试运行销售收入与成本(2024 年度：无)。

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(35) 税金及附加

	2025 年度	2024 年度
房产税	6,805,953.54	4,553,516.49
城市维护建设税	3,060,532.30	549,609.89
教育费附加	1,311,656.70	235,547.08
土地使用税	913,519.68	913,519.68
地方教育附加	874,437.80	157,031.40
印花税	854,909.28	623,435.54
环保税	50,061.53	24,043.08
	<u>13,871,070.83</u>	<u>7,056,703.16</u>

(36) 销售费用

	2025 年度	2024 年度
职工薪酬费用	6,860,627.67	5,684,672.61
销售代理费	3,267,100.63	4,604,950.00
样品费	1,811,660.22	1,297,785.10
办公费用	1,618,465.45	1,664,356.51
股权激励费用	1,547,676.41	451,749.28
其他	914,844.87	355,736.98
	<u>16,020,375.25</u>	<u>14,059,250.48</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(37) 管理费用

	2025 年度	2024 年度
职工薪酬费用	22,843,934.21	20,258,303.90
股权激励费用	6,884,516.34	2,388,467.83
折旧费和摊销费用	6,220,786.52	6,220,092.64
专业服务费	4,653,469.34	4,793,924.77
办公费用	3,424,891.73	3,246,347.83
残疾人就业保障金	679,720.60	588,966.55
租赁费	566,669.52	682,851.75
其他	540,413.01	903,935.39
	<u>45,814,401.27</u>	<u>39,082,890.66</u>

(38) 研发费用

	2025 年度	2024 年度
材料成本	44,271,069.42	37,051,419.10
职工薪酬	19,841,776.77	17,550,096.40
燃料动力费	14,816,485.70	12,494,609.34
折旧费和摊销费用	12,731,779.48	10,905,924.04
股权激励费用	673,991.95	221,891.96
其他	79,158.24	56,800.61
	<u>92,414,261.56</u>	<u>78,280,741.45</u>

(39) 财务费用

	2025 年度	2024 年度
租赁负债利息支出	203,196.71	338,852.82
利息收入	(9,545,308.11)	(20,445,299.09)
汇兑损益 - 净额	2,691,039.41	(632,078.51)
其他	156,921.12	222,290.68
	<u>(6,494,150.87)</u>	<u>(20,516,234.10)</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(40) 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

	2025 年度	2024 年度
耗用的原材料和低值易耗品等 库存商品、半成品及在产品存 货变动	365,210,855.91 (19,050,795.40)	379,629,174.46 (7,401,162.50)
职工薪酬费用	166,886,792.47	150,377,163.63
折旧费和摊销费用	102,434,798.53	90,866,818.83
燃料动力费	91,717,806.48	81,590,579.25
固定资产日常维修费用(ii)	30,966,477.85	25,873,987.23
股权激励费用	18,988,967.29	6,355,213.36
办公费用	6,263,421.76	6,268,151.80
咨询顾问费	3,923,103.05	4,103,696.02
销售代理费	3,267,100.63	4,604,950.00
分析测试费	3,249,988.03	3,055,847.44
运输费	2,496,903.25	2,768,154.76
环保费	1,884,940.25	1,343,563.37
租金(i)	716,862.72	848,331.15
其他	11,432,228.69	11,880,534.66
	<u>790,389,451.51</u>	<u>762,165,003.46</u>

(i) 如附注二(27)所述，本集团将短期租赁和低价值租赁的租金支出直接计入当期损益，2025 年度金额为 716,862.72 元(2024 年度：848,331.15 元)。

(ii) 针对不符合固定资产资本化条件的日常修理费用，本集团将与存货的生产和加工相关的计入存货成本并相应结转至营业成本，将与研发部门、行政部门和销售部门相关的分别计入研发费用、管理费用和销售费用。

(41) 资产减值损失/(转回)

	2025 年度	2024 年度
存货跌价损失/(转回) (附注四(8))	<u>5,517,863.98</u>	<u>(2,637,491.56)</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(42) 信用减值损失

	2025 年度	2024 年度
应收账款坏账损失 (附注四(4))	1,070,252.38	864,691.63
其他应收款坏账损失 (附注四(7))	15,626.13	74,728.02
	<u>1,085,878.51</u>	<u>939,419.65</u>

(43) 其他收益

	2025 年度	2024 年度
政府补助(附注四(28))		
—与收益相关	78,336,791.15	46,391,418.84
—与资产相关	8,496,553.19	8,496,553.19
增值税进项加计抵减	9,683,155.71	5,833,663.22
代扣代缴个税手续费返还	56,442.77	64,748.50
	<u>96,572,942.82</u>	<u>60,786,383.75</u>

(44) 投资损失

	2025 年度	2024 年度
权益法核算的长期股权投资 损失	(49,845,938.36)	(35,179,165.13)
处置交易性金融资产取得的投 资收益	31,784,514.56	30,234,906.89
处置长期股权投资产生的投资 收益	5,384,368.85	-
	<u>(12,677,054.95)</u>	<u>(4,944,258.24)</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(45) 公允价值变动收益

	2025 年度	2024 年度
银行理财产品	1,754,047.18	13,297,438.35

(46) 资产处置收益

	2025 年度	2024 年度	计入 2025 年 度非经常性 损益的金额
固定资产处置利得	77,610.72	-	77,610.72
使用权资产处置利得	-	84,500.61	-
	<u>77,610.72</u>	<u>84,500.61</u>	<u>77,610.72</u>

(47) 营业外收入

	2025 年度	2024 年度	计入 2025 年 度非经常性 损益的金额
保险赔款收入	486,847.01	-	486,847.01
罚没收入	38,500.00	90,110.71	38,500.00
非流动资产报废利得	7,734.51	-	7,734.51
其他	286,076.04	1,392,084.96	286,076.04
	<u>819,157.56</u>	<u>1,482,195.67</u>	<u>819,157.56</u>

(48) 营业外支出

	2025 年度	2024 年度	计入 2025 年 度非经常性 损益的金额
非流动资产报废损失	-	886,338.47	-
其他	219,368.10	465,040.77	219,368.10
	<u>219,368.10</u>	<u>1,351,379.24</u>	<u>219,368.10</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(49) 所得税费用

	2025 年度	2024 年度
按税法及相关规定计算的当期		
所得税	42,381,724.46	48,927,441.14
递延所得税	(1,182,555.40)	138,896.33
	<u>41,199,169.06</u>	<u>49,066,337.47</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2025 年度	2024 年度
利润总额	<u>287,202,945.75</u>	<u>318,293,333.38</u>
按适用税率 25%计算的所得税	71,800,736.44	79,573,333.35
税率变化的影响	215,256.37	(1,355,243.27)
不得扣除的成本、费用和损失	1,252,267.96	767,651.89
当期未确认递延所得税资产的暂时性差异	15,311.87	-
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	833,028.75	88,765.21
非应纳税收入	(1,996,065.44)	-
研发支出加计扣除	(15,286,119.80)	(9,484,530.80)
权益法核算的投资损失	12,461,484.59	8,794,791.28
以前年度汇算清缴差异	2,776,085.28	4,550,467.99
转回以前年度确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-	424,482.95
股份支付的影响	714,388.14	787,644.13
税收优惠的影响(附注三(2)(a))	(31,587,205.10)	(35,081,025.26)
所得税费用	<u>41,199,169.06</u>	<u>49,066,337.47</u>

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 四 合并财务报表项目附注(续)

#### (50) 每股收益

##### (a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2025 年度	2024 年度
归属于母公司普通股股东的合 并净利润(元)	209,280,637.60	232,903,753.41
本公司发行在外普通股的加权 平均数(股)	<u>1,244,212,615.15</u>	<u>1,244,838,734.69</u>
基本每股收益(元/股)	<u>0.17</u>	<u>0.19</u>
其中：		
—持续经营基本每股收益：	<u>0.17</u>	<u>0.19</u>

##### (b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2025 年度，本公司因股份期权导致具有稀释性的潜在普通股加权平均数为 22,921.71 股 (2024 年度：不存在具有稀释性的潜在普通股)，以此计算的稀释每股收益为 0.17 元/股。

#### (51) 现金流量表项目注释

本集团不存在以净额列报现金流量的情况，重大的现金流量项目列示如下：

##### (a) 收到其他与经营活动有关的现金

	2025 年度	2024 年度
政府补助	32,277,355.48	18,145,128.18
收到代垫费用	13,020,180.32	16,707,039.80
应付票据保证金	-	7,313,305.66
其他	<u>10,355,550.55</u>	<u>20,762,007.07</u>
	<u>55,653,086.35</u>	<u>62,927,480.71</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(51) 现金流量表项目注释(续)

(b) 支付其他与经营活动有关的现金

	2025 年度	2024 年度
支付代垫费用	13,020,180.32	16,707,039.80
办公费用	6,263,421.76	6,268,151.80
保证金	2,000,000.00	107,743.40
其他费用	5,154,887.07	1,898,121.15
	<u>26,438,489.15</u>	<u>24,981,056.15</u>

(c) 收回投资收到的现金

	2025 年度	2024 年度
到期赎回理财产品收到的现金	<u>8,290,000,000.00</u>	<u>9,480,000,000.00</u>

(d) 收到其他与投资活动有关的现金

	2025 年度	2024 年度
应付票据保证金	<u>21,732,043.82</u>	<u>2,630,349.81</u>

(e) 投资支付的现金

	2025 年度	2024 年度
购买理财产品支付的现金	8,290,000,000.00	10,040,000,000.00
联营企业增资支付的现金 (附注四(11))	<u>380,000,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>8,670,000,000.00</u>	<u>10,040,000,000.00</u>

(f) 支付其他与投资活动有关的现金

	2025 年度	2024 年度
应付票据保证金	37,618,611.67	-
保函保证金	-	5,000,000.17
	<u>37,618,611.67</u>	<u>5,000,000.17</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(51) 现金流量表项目注释(续)

(g) 支付其他与筹资活动有关的现金

	2025 年度	2024 年度
偿还租赁负债支付的金额	4,403,315.47	3,385,105.66
股份回购款(附注四(31))	-	35,935,687.59
	<u>4,403,315.47</u>	<u>39,320,793.25</u>

2025 年度，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为 5,120,178.19 元 (2024 年度：4,233,436.81 元)，除计入筹资活动的偿付租赁负债支付的金额以外，其余现金流出均计入经营活动。

(52) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2025 年度	2024 年度
净利润	246,003,776.69	269,226,995.91
加：资产减值损失/(转回)(附注四(41))	5,517,863.98	(2,637,491.56)
信用减值损失(附注四(42))	1,085,878.51	939,419.65
使用权资产折旧(附注四(14))	4,303,763.60	4,167,698.39
固定资产折旧(附注四(12))	92,629,269.44	81,947,095.31
无形资产摊销(附注四(15))	3,281,806.92	3,017,201.93
长期待摊费用摊销(附注四(17))	2,219,958.57	1,734,823.20
处置固定资产和使用权资产的利得(附注四(46))	(77,610.72)	(84,500.61)
非流动资产报废净(利得)/损失(附注四(47)、附注四(48))	(7,734.51)	886,338.47
公允价值变动收益(附注四(45))	(1,754,047.18)	(13,297,438.35)
财务费用	2,175,582.53	(284,462.32)
投资损失(附注四(44))	12,677,054.95	4,944,258.24
递延所得税资产(增加)/减少(附注四(18))	(1,218,384.80)	138,896.33
递延所得税负债增加(附注四(18))	35,829.40	-
递延收益摊销(附注四(28))	(86,833,344.34)	(54,887,972.03)
存货的增加(附注四(8))	(20,880,100.52)	(993,959.76)
权益结算的股份支付	18,988,967.29	6,355,213.36
经营性应收项目的增加	(80,714,017.63)	(154,691,498.62)
经营性应付项目的增加	66,973,691.04	96,501,003.14
受限制货币资金的减少/(增加)	9,782,460.17	(13,613,645.92)
经营活动产生的现金流量净额	<u>274,190,663.39</u>	<u>229,367,974.76</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(52) 现金流量表补充资料(续)

(b) 不涉及现金收支的重大经营、投资和筹资活动

	2025 年度	2024 年度
以银行承兑汇票支付存货采购款	304,984,378.46	272,333,667.74
以银行承兑汇票支付长期资产采购款	2,835,428.47	16,619,078.00
当期新增的使用权资产	2,927,960.01	298,449.62
	<u>310,747,766.94</u>	<u>289,251,195.36</u>

(c) 现金及现金等价物净变动情况

	2025 年度	2024 年度
现金及现金等价物的年末余额	618,291,520.43	905,848,935.90
减：现金及现金等价物的年初余额	<u>(905,848,935.90)</u>	<u>(1,477,120,831.11)</u>
现金及现金等价物净减少额	<u>(287,557,415.47)</u>	<u>(571,271,895.21)</u>

(d) 处置子公司及其他营业单位

	2025 年度	2024 年度
本年处置子公司及其他营业单位于 本年收到的现金和现金等价物	13,400,000.00	-
其中：北京艾唯特	8,000,000.00	-
山东尚泰	5,400,000.00	-
减：丧失控制日子子公司及其他营业 单位持有的现金和现金等价 物	(10,886,489.84)	-
其中：北京艾唯特	(10,886,489.84)	-
山东尚泰	-	-
处置子公司及其他营业单位支付的 现金净额	<u>2,513,510.16</u>	<u>-</u>

2025 年度处置子公司及其他营业单位的价格

北京艾唯特	12,844,911.00
山东尚泰	5,400,000.00
	<u>18,244,911.00</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(52) 现金流量表补充资料(续)

(d) 处置子公司及其他营业单位(续)

2025 年度处置子公司于处置日的净资产

流动资产	22,095,406.30
非流动资产	4,953,969.02
流动负债	(3,252,191.96)
非流动负债	(126,803.42)
	<u>23,670,379.94</u>

(e) 筹资活动产生的各项负债的变动情况

租赁负债(含一年内到期)

2024 年 12 月 31 日	6,977,464.33
筹资活动产生的现金流量净额(附注四 (51)(g))	(4,403,315.47)
本年计提的利息(附注四(39))	203,196.71
不涉及现金收支的变动(附注四(52)(b))	2,927,960.01
处置子公司减少	(186,404.15)
2025 年 12 月 31 日	<u>5,518,901.43</u>

(f) 现金及现金等价物

2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

现金	666,868,072.72	1,029,893,380.40
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	618,291,520.43	905,848,935.90
其他货币资金	48,576,552.29	124,044,444.50
减：受限资金(i)	(48,576,552.29)	(124,044,444.50)
年末现金及现金等价物余额	<u>618,291,520.43</u>	<u>905,848,935.90</u>

(i) 如附注四(1)所述，于 2025 年 12 月 31 日，48,576,552.29 元的其他货币资金(2024 年 12 月 31 日：124,044,444.50 元)不属于现金及现金等价物。

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(53) 外币货币性项目

	2025 年 12 月 31 日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金—			
美元	26,399,209.06	7.0288	185,554,760.66
日元	7,890,906.00	0.0448	353,488.91
			<u>185,908,249.57</u>
应收账款—			
美元	4,888,556.91	7.0288	34,360,688.80
应付账款—			
美元	1,669,257.40	7.0288	11,732,876.42
日元	13,200,000.00	0.0448	591,320.40
			<u>12,324,196.82</u>
其他应付款—			
美元	67,008.37	7.0288	470,988.43
日元	121,170,000.00	0.0448	5,428,052.49
			<u>5,899,040.92</u>

上述外币货币性项目中的外币是指除人民币之外的所有货币。

(54) 所有权或使用权受限制的资产

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本集团存在以下所有权或使用权受限制的资产：

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	受限原因
货币资金	48,576,552.29	124,044,444.50	保证金
应收票据	33,857,482.80	37,068,579.02	已背书未到期
	<u>82,434,035.09</u>	<u>161,113,023.52</u>	

## 有研半导体硅材料股份公司

### 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 五 合并范围的变更

### (1) 处置子公司

(a) 本年度处置子公司的相关信息汇总如下：

子公司名称	处置价款	原持股比例	处置比例	剩余比例	处置方式	丧失控制权时点	丧失控制权时的判断依据	处置产生的投资收益(b)	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入留存收益的金额
北京艾唯特(i)	12,884,911.00	79.48%	49.48%	30.00%	现金出售	2025 年 12 月 31 日	董事会重组且收到大部分对价款	1,883,693.03	-	-

(i) 2025 年度，本集团转让其持有的北京艾唯特 49.48% 的股权，转让后，剩余股权比例为 30.00%。上述交易完成后，本集团不再拥有对北京艾唯特的控制权。本集团有权提名一名董事，参与或影响其财务和经营决策，对北京艾唯特具有重大影响，将其作为联营企业采用权益法核算(附注四(11))。

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并范围的变更(续)

(1) 处置子公司(续)

(b) 处置损益如下：

北京艾唯特

处置损益计算如下：

	金额
处置价格	12,884,911.00
剩余 30%的股权在处置日的公允价值	7,812,000.00
减：合并财务报表层面享有的北京艾唯特净资产份额	(18,813,217.97)
	<hr/> 1,883,693.03
其他综合收益转入当期损益	-
转回处置前未实现内部交易损益的金额	-
处置产生的投资收益	<hr/> <hr/> 1,883,693.03

在丧失控制权之日，剩余 30%股权的公允价值的确定方法为收益法。

## 有研半导体硅材料股份公司

### 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

#### 六 在其他主体中的权益

##### (1) 在子公司中的权益

##### (a) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
山东有研半导体	山东省德州市	山东省德州市	2,003,281,126.00 人民币	半导体材料及其他新材料的研发、生产、销售和贸易	85.02%	-	投资设立
山东研晶石英科技有限公司(“山东研晶”)(i)	山东省济宁市	山东省济宁市	20,000,000.00 人民币	石英坩埚及其他电子材料的研发、生产及销售；货物与技术进出口	-	43.36%	投资设立

(i) 于 2025 年 8 月，本公司之子公司山东有研半导体与山东恒圣石墨分别出资 10,200,000.00 元及 9,800,000.00 元设立山东研晶，其中山东有研半导体持股 51.00%。

##### (b) 存在重要少数股东权益的子公司

本集团综合考虑子公司是否为上市公司、其少数股东权益占本集团合并股东权益的比例、少数股东损益占本集团合并净利润的比例等因素，确定存在重要少数股东权益的子公司，列示如下：

子公司名称	少数股东的持股比例	2025 年度归属于少数股东的损益	2025 年度向少数股东分派的股利(i)	2025 年 12 月 31 日少数股东权益
山东有研半导体	14.98%	37,478,987.04	11,081,796.00	486,288,847.71

(i) 2025 年度向少数股东宣告分派的股利，均已于当年支付。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 六 在其他主体中的权益(续)

#### (1) 在子公司中的权益(续)

#### (b) 存在重要少数股东权益的子公司(续)

上述重要非全资子公司的主要财务信息列示如下：

	2025 年 12 月 31 日					2024 年 12 月 31 日						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东有研半 导体(i)	2,271,838,377.61	1,356,623,306.81	3,628,461,684.42	299,131,802.04	136,190,467.28	435,322,269.32	2,201,308,555.07	1,300,263,545.72	3,501,572,100.79	308,631,052.36	189,158,530.66	497,789,583.02

	2025 年度				2024 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量
山东有研半导体 (i)	933,842,900.66	251,294,172.41	251,294,172.41	283,665,572.05	904,504,055.97	242,582,398.47	242,582,398.47	165,983,384.05

(i) 山东有研半导体 2025 年 12 月 31 日及 2025 年度的主要财务信息为包含山东研晶的合并财务报表数据(2024 年 12 月 31 日及 2024 年度的主要财务信息为山东有研半导体单体财务报表数据)。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 六 在其他主体中的权益(续)

#### (2) 在联营企业中的权益

##### (a) 重要联营企业的基础信息

本集团综合考虑联营企业是否为上市公司、其账面价值占本集团合并总资产的比例、权益法核算的长期股权投资收益占本集团合并净利润的比例等因素，确定重要的联营企业，列示如下：

联营企业 -	主要 经营地	注册地	业务性质	对集团活 动是否具 有战略性	持股比例		本集团在被 投资单位表 决权比例	对联营企业 投资的会计 处理方法
					直接	间接		
山东有研艾斯(i)	山东省 德州市	山东省 德州市	半导体材料及其 他新材料的研 发、生产、销售	是	28.11%	-	33.33%	权益法核算

本集团对上述股权投资采用权益法核算。

(i) 如附注四(11)(a)(i)所述，本集团对向山东有研艾斯的持股比为 28.11%，同时山东有研艾斯董事会 3 名董事中的 1 名由本集团任命，从而本集团能够对山东有研艾斯施加重大影响，故将其作为联营企业核算。根据山东有研艾斯公司章程，三方股东按照 1: 1: 1 行使股东会会议的表决权，因此本集团享有 33.33%的表决权比例。

##### (b) 重要联营企业的主要财务信息

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
	山东有研艾斯	山东有研艾斯
流动资产	714,134,179.62	781,400,886.20
非流动资产	2,012,150,229.15	1,654,205,286.61
资产合计	2,726,284,408.77	2,435,606,172.81
流动负债	313,205,551.09	272,015,085.36
非流动负债	30,385,603.55	44,224,938.44
负债合计	343,591,154.64	316,240,023.80
净资产	2,382,693,254.13	2,119,366,149.01
按持股比例计算的净资产份额(i)	669,775,073.74	423,661,293.19
调整事项 1	9,124,300.87	255,855.62
调整事项 2(ii)	-	(75,962,000.00)
对联营企业权益投资的账面价值	678,899,374.61	347,955,148.81
	2025 年度	2024 年度
	山东有研艾斯	山东有研艾斯
营业收入	208,272,971.21	105,666,126.91
净亏损	(174,985,637.23)	(161,760,705.56)
综合亏损总额	(174,985,637.23)	(161,760,705.56)

## 有研半导体硅材料股份公司

### 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

#### 六 在其他主体中的权益(续)

##### (2) 在联营企业中的权益(续)

##### (b) 重要联营企业的主要财务信息(续)

于 2025 年度及 2024 年度，本集团无收到的来自联营企业的股利。

(i) 本集团以联营企业财务报表中净资产的金额为基础，按应分享比例计算相应的净资产份额。联营企业财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。本集团与联营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。

(ii) 于 2024 年 12 月 30 日，山东有研艾斯的三方股东，即中国有研、本公司以及德州汇达半导体股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同签署对山东有研艾斯的增资协议。协议约定中国有研和本集团分别以人民币 380,000,000.00 元向山东有研艾斯增资，增资后，中国有研和本公司在山东有研艾斯的股权比例将从 19.99%及 19.99%分别上升至 28.11%及 28.11%。

于 2024 年 12 月 31 日，双方共同增资尚未完成。根据协议约定，在双方共同增资完成前按照原比例享有山东有研艾斯之股东权益，因此山东有研艾斯于 2024 年 12 月 30 日收到的中国有研人民币 380,000,000.00 元增资款在计算本集团 2024 年 12 月 31 日应享有的山东有研艾斯净资产份额时予以扣除。

##### (c) 不重要联营企业的汇总信息

如附注四(11)所述，于 2025 年 12 月 31 日，本集团能够对北京艾唯特施加重大影响，将其作为联营企业核算(2024 年 12 月 31 日：北京艾唯特为本集团子公司)。于 2025 年 7 月 15 日，本集团处置了持有的山东尚泰 9%的股权(2024 年 12 月 31 日：山东尚泰为本集团联营企业)。

不重要联营企业的主要财务信息如下：

	2025 年度		2024 年度
	北京艾唯特	山东尚泰	山东尚泰
投资账面价值合计	7,812,000.00	-	2,556,799.91
下列各项按持股比例计算的合计数	-	(657,475.73)	(2,843,200.09)
净亏损(i)	(3,683,469.55)	(7,305,285.89)	(31,547,892.19)
综合亏损总额	(3,683,469.55)	(7,305,285.89)	(31,547,892.19)

## 有研半导体硅材料股份公司

### 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

#### 六 在其他主体中的权益(续)

##### (2) 在联营企业中的权益(续)

##### (c) 不重要联营企业的汇总信息(续)

(i) 净亏损和其他综合亏损均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

#### 七 关联方关系及其交易

##### (1) 母公司情况

##### (a) 母公司基本情况

	注册地	业务性质
RS Technologies	日本东京	电子材料、电子器械部品、通信器 械部品材料的制造、加工及再生等

本公司的最终控制方为 RS Technologies。

##### (b) 母公司注册资本及其变化

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
RS Technologies	5,701,730,000 日元	158,667,378 日元	-	5,860,397,378 日元

##### (c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
RS Technologies	26.24%	59.36%	26.29%	59.49%

于 2023 年 12 月 31 日，RS Technologies 直接持股获得 26.22% 的表决权和通过北京有研艾斯间接持股获得本公司 30.84% 的表决权。同时，RS Technologies 与仓元投资(持股比例：2.26%)签署了一致行动函，约定仓元投资在董事会上就决议事项行使表决权时与 RS Technologies 保持一致行动，由此 RS Technologies 共计获得对本公司 59.32% 的表决权。于 2024 年 12 月 31 日，根据相关法规，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此母公司对本企业的表决权比例按扣除回购账户中的股份数来计算，直接持股比例及表决权比例上升为 26.29% 和 59.49%。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 七 关联方关系及其交易(续)

#### (1) 母公司情况(续)

#### (c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例(续)

2025 年度，本公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期第一次行权新增股份 2,680,800 股，本公司总股本由 1,247,621,058 股增加至 1,250,301,858 股。于 2025 年 12 月 31 日，母公司对本企业的表决权比例按扣除回购账户中的股份数来计算，直接持股比例及表决权比例下降为 26.24%和 59.36%。

#### (2) 子公司情况

子公司的基本情况及相关信息见附注六(1)。

#### (3) 其他关联方情况

与本集团的关系

山东有研艾斯	联营企业
北京艾唯特(i)	联营企业
中国有研	本公司之少数股东
国标(北京)检验认证有限公司	本公司少数股东之子公司
有科期刊出版(北京)有限公司	本公司少数股东之子公司
有研兴友科技服务(北京)有限公司	本公司少数股东之子公司
国合通用测试评价认证股份公司	本公司少数股东之子公司
有研稀土新材料股份有限公司	本公司少数股东之子公司
有研国晶辉新材料有限公司	本公司少数股东之子公司
RSTEC Semiconductor Taiwan Co., LTD.	本公司母公司之子公司
DG Technologies Co., Ltd.	本公司母公司之子公司
IVT 株式会社(i)	本公司联营企业之少数股东
山东恒圣石墨	本公司孙公司之少数股东
山东尚泰(ii)	本公司孙公司之少数股东之子公司
山东恒圣新材料有限公司(“山东恒圣新材料”)	本公司孙公司之少数股东之子公司
山东恒圣光伏新能源有限公司(“山东恒圣光伏”)	本公司孙公司之少数股东之孙公司

(i) 如附注四(11)(a)(iii)所述，北京艾唯特自 2025 年 12 月 31 日起由本公司子公司转为本公司联营企业，IVT 株式会社(北京艾唯特之少数股东)不再与本集团构成关联方关系。

(ii) 如附注四(11)(a)(ii)所述，山东尚泰自 2025 年 7 月 15 日起由本公司联营企业转为本公司孙公司之少数股东之子公司。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 七 关联方关系及其交易(续)

#### (4) 关联交易

##### (a) 购销商品、提供和接受劳务

采购商品、接受劳务：

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	获批的交易额度	是否超过交易额度	2025 年度	2024 年度
山东有研艾斯	采购商品	以市场价作为参考价	90,000,000.00	否	23,676,692.00	10,818,947.57
山东尚泰	采购商品	以市场价作为参考价	30,000,000.00	否	5,894,296.38	221,946.89
山东恒圣石墨	采购商品	以市场价作为参考价	不适用*	不适用*	239,168.99	-
山东恒圣光伏	采购商品	以市场价作为参考价	不适用*	不适用*	28,337.62	-
IVT 株式会社	采购商品	以市场价作为参考价	1,000,000.00	否	22,781.75	15,594.71
国标(北京)检验认证有限公司	采购商品	以市场价作为参考价			5,176.99	-
国标(北京)检验认证有限公司	接受劳务	以市场价作为参考价	5,000,000.00	否	1,861,561.30	1,476,028.30
中国有研	接受劳务	以市场价作为参考价			401,939.39	405,493.44
山东有研艾斯	接受劳务	以市场价作为参考价	300,000.00	否	201,373.20	201,373.20
					<u>32,331,327.62</u>	<u>13,139,384.11</u>

\* 系非持续性的关联交易，故未事先获批相关交易额度。

销售商品、提供劳务：

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2025 年度	2024 年度
RS Technologies	销售产品	以市场价作为参考价	97,068,349.75	67,988,934.95
有研国晶辉新材料有限公司	销售产品	以市场价作为参考价	1,663,092.93	-
RSTEC Semiconductor Taiwan Co., LTD.	销售产品	以市场价作为参考价	759,410.28	846,042.30
山东尚泰	销售产品	以市场价作为参考价	477,009.65	11,150,442.46
有研稀土新材料股份有限公司	销售产品	以市场价作为参考价	-	21,238.94
山东有研艾斯	提供劳务	以市场价作为参考价	14,616,837.68	18,842,398.25
山东尚泰	提供劳务	以市场价作为参考价	132,559.06	-
国标(北京)检验认证有限公司	提供劳务	以市场价作为参考价	5,660.38	-
			<u>114,722,919.73</u>	<u>98,849,056.90</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联交易(续)

(b) 采购设备

关联方	2025 年度	2024 年度
山东尚泰	10,149,571.00	-
山东有研艾斯	5,637,640.63	-
RS Technologies	4,703,685.00	-
RSTEC Semiconductor Taiwan Co., LTD.	-	3,248,208.00
	<u>20,490,896.63</u>	<u>3,248,208.00</u>

(c) 租赁

本集团作为出租方当年确认的租赁收入：

承租方名称	租赁资产种类	2025 年度	2024 年度
山东有研艾斯	房屋建筑物	<u>426,456.12</u>	<u>1,908,324.12</u>

本集团作为承租方当年新增的使用权资产：

出租方名称	租赁资产种类	2025 年度	2024 年度
山东恒圣新材料	房屋建筑物	2,682,061.24	-
山东有研艾斯	房屋建筑物	-	298,449.62
		<u>2,682,061.24</u>	<u>298,449.62</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联交易(续)

(c) 租赁(续)

本集团作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

出租方名称	租赁资产种类	2025 年度	2024 年度
中国有研	房屋建筑物	161,113.22	298,932.88
山东恒圣新材料	房屋建筑物	26,785.70	-
山东有研艾斯	房屋建筑物	8,967.07	11,318.42
		<u>196,865.99</u>	<u>310,251.30</u>

本集团作为承租方直接计入当期损益的短期租赁和低价值租赁的租金费用：

出租方名称	租赁资产种类	2025 年度	2024 年度
中国有研	房屋建筑物	<u>86,685.73</u>	<u>76,809.51</u>

本集团作为承租方支付的租金：

出租方名称	租赁资产种类	2025 年度	2024 年度
中国有研	房屋建筑物	3,673,171.27	2,944,962.39
山东恒圣新材料	房屋建筑物	468,110.10	-
山东有研艾斯	房屋建筑物	66,165.48	66,165.48
		<u>4,207,446.85</u>	<u>3,011,127.87</u>

(d) 商标使用费

关联方	2025 年度	2024 年度
中国有研	<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>

(e) 本集团为关联方代收代付款项

关联方	2025 年度	2024 年度
山东有研艾斯	<u>11,599,877.42</u>	<u>14,943,590.97</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联交易(续)

(f) 关联方为本集团代收代付款项

关联方	2025 年度	2024 年度
山东恒圣新材料	54,084.37	-
中国有研	40,202.49	77,526.45
山东有研艾斯	34,908.83	35,781.55
山东尚泰	21,533.52	-
	<u>150,729.21</u>	<u>113,308.00</u>

(g) 关键管理人员薪酬

	2025 年度	2024 年度
关键管理人员工资	3,917,030.15	3,902,570.15
关键管理人员股份支付费用	1,769,919.68	591,711.90
	<u>5,686,949.83</u>	<u>4,494,282.05</u>

(5) 关联方余额

	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
RS Technologies	19,784,068.79	(296,761.04)	8,920,857.59	(133,812.86)
山东尚泰	539,020.90	(8,085.31)	-	-
有研国晶辉新材料有限公司	217,000.00	(3,255.00)	-	-
RSTEC Semiconductor Taiwan Co., LTD.	189,777.60	(2,846.66)	142,330.32	(2,134.95)
	<u>20,729,867.29</u>	<u>(310,948.01)</u>	<u>9,063,187.91</u>	<u>(135,947.81)</u>

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付账款		
山东尚泰	1,680,461.41	220,400.00
国标(北京)检验认证有限公司	541,980.00	-
山东恒圣石墨	113,548.00	-
山东恒圣新材料	8,789.82	-
IVT 株式会社	-	15,598.83
DG Technologies Co., Ltd.	-	6,703.79
	<u>2,344,779.23</u>	<u>242,702.62</u>

## 有研半导体硅材料股份公司

### 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

#### 七 关联方关系及其交易(续)

##### (5) 关联方余额(续)

		2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
其他应付款	RS Technologies	4,703,685.00	-
	山东尚泰	579,015.23	-
	RSTEC Semiconductor Taiwan Co., LTD.	-	1,940,868.00
		<u>5,282,700.23</u>	<u>1,940,868.00</u>
租赁负债	中国有研	3,153,267.09	6,665,325.14
	山东恒圣新材料	2,240,736.84	-
	山东有研艾斯	-	243,602.56
		<u>5,394,003.93</u>	<u>6,908,927.70</u>
应付职工薪酬	关键管理人员	<u>1,135,693.33</u>	<u>1,170,000.00</u>

#### 八 股份支付

##### (1) 以权益结算的股份支付

###### (a) 股票期权计划

根据 2024 年 10 月 10 日召开的董事会和监事会会议决议通过的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，本公司向 92 名激励对象实施股票期权激励计划，共授予激励对象 1,145.00 万份股票期权(“首次授予”)。该股票期权的行权价格为 9.11 元/股，激励对象自授予日(2024 年 10 月 10 日)起分三次行权，对应的等待期分别为自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月。股票期权的有效期为自 2024 年 10 月 10 日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 72 个月。

根据 2025 年 3 月 14 日召开的董事会和监事会会议决议通过的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，本公司向 34 名激励对象授予 90.00 万份股票期权(“预留部分授予”)。该股票期权的行权价格为 9.11 元/份，激励对象自授予日(2025 年 3 月 14 日)起分三次行权，对应的等待期分别为自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月。股票期权的有效期为自 2025 年 3 月 14 日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 72 个月。

于 2025 年 10 月 27 日，本公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由 9.11 元/股调整为 9.05 元/股。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 八 股份支付(续)

#### (1) 以权益结算的股份支付(续)

##### (a) 股票期权计划(续)

于 2025 年 10 月 27 日，本公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于确认公司 2024 年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》、《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销 2024 年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》，同意 92 名激励对象的 268.08 万份股票期权予以行权，行权价格为每份 9.05 元。同时，鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面 2024 年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为 80%，同时部分激励对象因个人考核条件未达成 A 导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计 75.42 万份，公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权。

##### (b) 年度内股票期权变动情况表

	2025年度		2024年度	
	数量	金额	数量	金额
年初发行在外的股票期权	11,450,000.00	51,061,123.17	-	-
本年授予的股票期权	900,000.00	3,824,223.94	11,450,000.00	51,061,123.17
本年行权的股票期权	(2,680,800.00)	(10,902,098.12)	-	-
本年注销的股票期权	(754,200.00)	(3,067,130.10)	-	-
年末发行在外的股票期权	<u>8,915,000.00</u>	<u>40,916,118.89</u>	<u>11,450,000.00</u>	<u>51,061,123.17</u>
其中：年末已达到可行权条件的股票期权	-	-	-	-
本年股份支付费用		18,988,967.29		6,355,213.36
累计股份支付费用		25,344,180.65		6,355,213.36

2025 年度股份支付费用计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的金额分别为 9,882,782.59 元、1,547,676.41 元、6,884,516.34 元及 673,991.95 元 (2024 年度：股份支付费用计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的金额分别为 3,293,104.29 元、451,749.28 元、2,388,467.83 元及 221,891.96 元)。

## 有研半导体硅材料股份公司

### 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

#### 八 股份支付(续)

##### (1) 以权益结算的股份支付(续)

(c) 年末发行在外的股票期权行权价格均为 9.05 元。截至 2025 年 12 月 31 日，股票期权合同剩余期限分别至 2027 年 10 月 9 日及 2028 年 3 月 13 日。

##### (d) 授予日股票期权公允价值的确定方法

本集团采用布莱克-舒尔斯期权定价模型确定股票期权的公允价值。

首次授予的主要参数列示如下：

期权行权价格：	9.11元
期权的有效期：	1 - 3年
标的股份的现行价格：	12.65元
股价预计波动率：	34.68% - 39.86%
预计股息率：	0.54%
期权有效期内的无风险利率：	1.4379% - 1.6459%

本集团根据以上参数计算的得出的首次授予每股股票期权的公允价值为：4.07元、4.40元及4.80 元。

预留部分授予的主要参数列示如下：

期权行权价格(i)：	9.11元
期权的有效期：	1 - 3年
标的股份的现行价格：	12.26元
股价预计波动率：	36.43% - 43.09%
预计股息率：	0.54%
期权有效期内的无风险利率：	1.5629% - 1.6214%

本集团根据以上参数计算的得出的预留部分每股股票期权的公允价值为：3.85元、4.20元及4.59 元。

(i) 根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》的规定，在激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，若公司发生派发股票红利情况，股票期权的行权价格和权益数量将做相应的调整。于2025年10月27日，经公司董事会决议，股票期权的行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。上述每股股票期权的公允价值的计算参数不因预期行权价格调整而改变。

## 有研半导体硅材料股份公司

### 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

#### 九 或有事项

于 2025 年 12 月 31 日，本集团不存在重大或有事项。

#### 十 承诺事项

##### (1) 资本性支出承诺事项

已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>21,690,268.51</u>	<u>44,546,222.46</u>

##### (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
一年以内	<u>388,699.41</u>	<u>90,000.00</u>

#### 十一 资产负债表日后事项

##### (1) 利润分配情况说明

金额

拟分配的股利(a)	68,571,058.71 元
经审议批准宣告发放的股利	-

- (a) 根据 2026 年 3 月 25 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利 68,571,058.71 元，尚待本公司股东会审议批准，未在本财务报表中确认为负债。

## 有研半导体硅材料股份公司

### 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 十一 资产负债表日后事项(续)

### (2) 现金收购株式会社 DG Technologies

于 2025 年 3 月 14 日，根据本公司第二届董事会第七次会议通过的《关于现金收购株式会社 DG Technologies 股权暨关联交易的议案》，本公司拟以日元 119,138.82 万元(折合人民币 5,846.97 万元)的对价购买本公司母公司 RS Technologies 持有的 DG Technologies 70%的股份，本次收购不构成重大资产重组。

截至 2026 年 1 月 31 日止，本公司已支付交易首笔对价款 83,397.17 万日元(折合人民币 3,766.88 万元)，标的股权转让已完成，本公司对 DG Technologies 的财务和生产经营实施控制。

### (3) 最终控制方减持公司股份

于 2026 年 2 月 13 日，本公司收到最终控制方 RS Technologies 及一致行动人仓元投资出具的《关于股份减持结果的告知函》。截至 2026 年 2 月 13 日止，仓元投资通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,250.00 万股，占公司股份总数的 1.00%；RS Technologies 和仓元投资通过大宗交易方式累计减持公司股份 2,500.00 万股，占公司股份总数的 2.00%。该减持计划已实施完毕，最终控制方及其一致行动人合计持有公司股份比例由 59.19%减少至 56.19%。

### (4) 使用部分超募资金设立全资子公司

于 2026 年 3 月 19 日，本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案》，拟设立全资子公司“国晶半导体材料(包头)有限公司”(公司名称以市场监督管理部门最终核定的信息为准)，并以此为主体投资新建“大尺寸半导体硅单晶基地建设项目”，该项目计划总投资人民币 40,000.00 万元，其中拟使用超募资金人民币 194,70.15 万元、自有资金人民币 20,529.85 万元。

## 十二 资产负债表日后经营租赁收款额

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
一年以内	426,456.12	106,614.03
一到二年	106,614.03	-
	<u>533,070.15</u>	<u>106,614.03</u>

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 十三 金融工具及相关风险

本集团的经营活​​动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

#### (1) 市场风险

##### (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。

本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。于 2025 年度，本集团无外币借款且没有签署任何远期外汇合约(2024 年度：无)。

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2025 年 12 月 31 日		合计
	美元项目	其他外币项目	
外币金融资产 —			
货币资金	185,554,760.66	353,488.91	185,908,249.57
应收账款	34,360,688.80	-	34,360,688.80
	<u>219,915,449.46</u>	<u>353,488.91</u>	<u>220,268,938.37</u>
外币金融负债 —			
应付账款	11,732,876.42	591,320.40	12,324,196.82
其他应付款	470,988.43	5,428,052.49	5,899,040.92
	<u>12,203,864.85</u>	<u>6,019,372.89</u>	<u>18,223,237.74</u>

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 十三 金融工具及相关风险(续)

#### (1) 市场风险(续)

##### (a) 外汇风险(续)

	2024 年 12 月 31 日		合计
	美元项目	其他外币项目	
外币金融资产 —			
货币资金	78,122,890.50	75,086.23	78,197,976.73
应收账款	30,748,998.12	-	30,748,998.12
	<u>108,871,888.62</u>	<u>75,086.23</u>	<u>108,946,974.85</u>
外币金融负债 —			
应付账款	12,466,658.47	1,552,735.31	14,019,393.78
其他应付款	3,860,794.32	1,061,509.68	4,922,304.00
	<u>16,327,452.79</u>	<u>2,614,244.99</u>	<u>18,941,697.78</u>

于 2025 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加利润总额约 10,386,000.00 元 (2024 年 12 月 31 日：减少或增加利润总额约 4,627,000.00 元)。

##### (b) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2025 年 12 月 31 日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌 5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额约 1,500,000.00 元(2024 年 12 月 31 日：1,500,000.00 元)。

#### (2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 十三 金融工具及相关风险(续)

#### (2) 信用风险(续)

对于应收账款、应收票据、应收款项融资和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2025 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级(2024 年 12 月 31 日：无)。

#### (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时，持续监控是否符合借款协议的规定，并综合考虑利率水平、借款期限、增信措施等融资条件，筛选不同的金融机构以获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2025 年 12 月 31 日			合计
	一年以内	一到二年	二到五年	
应付票据	46,555,914.88	-	-	46,555,914.88
应付账款	140,254,547.92	-	-	140,254,547.92
其他应付款	107,052,492.96	-	-	107,052,492.96
租赁负债	4,243,499.59	936,220.20	468,110.10	5,647,829.89
	<u>298,106,455.35</u>	<u>936,220.20</u>	<u>468,110.10</u>	<u>299,510,785.65</u>

	2024 年 12 月 31 日			合计
	一年以内	一到二年	二到五年	
应付票据	115,721,960.05	-	-	115,721,960.05
应付账款	114,984,070.90	-	-	114,984,070.90
其他应付款	87,248,694.13	-	-	87,248,694.13
租赁负债	5,029,306.15	2,025,904.09	165,413.70	7,220,623.94
	<u>322,984,031.23</u>	<u>2,025,904.09</u>	<u>165,413.70</u>	<u>325,175,349.02</u>

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 十四 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

#### (1) 持续的以公允价值计量的资产和负债

于 2025 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
交易性金融资产 —				
银行理财产品	-	-	1,910,302,191.79	1,910,302,191.79
应收款项融资 —				
应收票据	-	-	90,341,764.46	90,341,764.46
其他非流动金融资产	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,030,643,956.25</u>	<u>2,030,643,956.25</u>

于 2024 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
交易性金融资产 —				
银行理财产品	-	-	1,910,071,561.64	1,910,071,561.64
应收款项融资 —				
应收票据	-	-	129,563,009.25	129,563,009.25
其他非流动金融资产	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,069,634,570.89</u>	<u>2,069,634,570.89</u>

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和最近融资隐含倍率调整法模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、流动性溢价、EBITDA 乘数、企业价值与销售额比率、市场倍率的调整等。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 十四 公允价值估计(续)

#### (1) 持续的以公允价值计量的资产和负债(续)

上述第三层次资产和负债变动如下：

	2024 年 12 月 31 日	增加	减少	当期利得或损失总额		2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 仍持有的资产计入当期损益的未 实现利得或损失的变动 —公允价值变动损益
				计入当期损益的 利得或损失(i)	计入其他综合收益 的利得或损失		
金融资产							
交易性金融资产 —							
银行理财产品	<u>1,910,071,561.64</u>	<u>8,290,000,000.00</u>	<u>(8,323,307,931.59)</u>	<u>33,538,561.74</u>	<u>-</u>	<u>1,910,302,191.79</u>	<u>302,191.79</u>
应收款项融资 —							
应收票据	<u>129,563,009.25</u>	<u>387,833,375.01</u>	<u>(427,054,619.80)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>90,341,764.46</u>	<u>-</u>
其他非流动金融资产	<u>30,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>2,069,634,570.89</u>	<u>8,677,833,375.01</u>	<u>(8,750,362,551.39)</u>	<u>33,538,561.74</u>	<u>-</u>	<u>2,030,643,956.25</u>	<u>302,191.79</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债(续)

上述第三层次资产和负债变动如下(续):

	2023 年		增加	减少	当期利得或损失总额		2024 年	2024 年 12 月 31 日 仍持有的资产计入当期损益的未 实现利得或损失的变动 —公允价值变动损益
	12 月 31 日				计入当期损益的 利得或损失(i)	计入其他综合收益 的利得或损失		
金融资产								
交易性金融资产 —								
银行理财产品	1,351,953,493.15	10,040,000,000.00	(9,525,414,276.75)	43,532,345.24	-	1,910,071,561.64	71,561.64	
应收款项融资—								
应收票据	52,353,799.21	381,188,733.75	(303,979,523.71)	-	-	129,563,009.25	-	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00	-	
	<u>1,434,307,292.36</u>	<u>10,421,188,733.75</u>	<u>(9,829,393,800.46)</u>	<u>43,532,345.24</u>	<u>-</u>	<u>2,069,634,570.89</u>	<u>71,561.64</u>	

(i) 计入当期损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益和投资收益项目。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 十四 公允价值估计(续)

#### (1) 持续的以公允价值计量的资产和负债(续)

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	2025 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/加权 平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
交易性金融资产 — 银行理财产品	<u>1,910,302,191.79</u>	预期收益法	预期收益率	0.70%-2.45%	正相关	不可观察
应收款项融资 — 应收票据	<u>90,341,764.46</u>	现金流量折现 模型	折现率	1.33%-1.96%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产	<u>30,000,000.00</u>	最近融资隐含 比率调整法	企业价值与销售 额比率/ 市场倍率的调整	7.2/ 10.6%	正相关	不可观察
	<u>2,030,643,956.25</u>					

	2024 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/加权 平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
交易性金融资产 — 银行理财产品	<u>1,910,071,561.64</u>	预期收益法	预期收益率	0.85%-2.90%	正相关	不可观察
应收款项融资 — 应收票据	<u>129,563,009.25</u>	现金流量折 现模型	折现率	1.45%-2.16%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产	<u>30,000,000.00</u>	市场法	被投资单位最近 融资价格	不适用	不适用	不适用
	<u>2,069,634,570.89</u>					

#### (2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、应付款项和租赁负债等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 十五 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产负债率	<u>8.87%</u>	<u>10.63%</u>

### 十六 公司财务报表附注

#### (1) 应收账款

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应收账款	31,442,445.49	9,033,691.16
减：坏账准备	<u>(362,058.49)</u>	<u>(135,505.37)</u>
	<u>31,080,387.00</u>	<u>8,898,185.79</u>

#### (a) 应收账款账龄分析如下：

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
180 天以内	<u>31,442,445.49</u>	<u>9,033,691.16</u>

#### (b) 于 2025 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款 余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	<u>25,683,320.82</u>	<u>(275,671.62)</u>	<u>81.68%</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(1) 应收账款(续)

(c) 本公司本年度无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2024 年度：无)。

(d) 坏账准备

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本公司无单项计提坏账准备的应收账款。

(i) 组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 — 关联方客户组合

	2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期 预期信用损 失率	金额	金额	整个存续期 预期信用损 失率	金额
180 天以内	<u>7,305,212.55</u>	-	-	-	-	-

组合 — 第三方客户组合

	2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期 预期信用损 失率	金额	金额	整个存续期 预期信用损 失率	金额
180 天以内	<u>24,137,232.94</u>	1.50%	<u>(362,058.49)</u>	<u>9,033,691.16</u>	1.50%	<u>(135,505.37)</u>

(ii) 本年度计提的坏账准备金额为 362,058.49 元(2024 年度：135,505.37 元)，收回的坏账准备金额为 135,505.37 元(2024 年度：192,444.71 元)。

(iii) 本年度无实际核销的应收账款(2024 年度：无)。

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(2) 其他应收款

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应收处置子公司款项	4,884,911.00	-
应收押金、保证金及备用金	67,170.61	39,950.00
	<u>4,952,081.61</u>	<u>39,950.00</u>
减：坏账准备	(82,131.22)	(6,291.75)
	<u>4,869,950.39</u>	<u>33,658.25</u>

本公司不存在因资金集中管理而将款项归集于其他方并列报于其他应收款的情况。

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
180 天以内	4,942,081.61	19,950.00
181 至 365 天	-	-
一到二年	-	20,000.00
二年以上	10,000.00	-
	<u>4,952,081.61</u>	<u>39,950.00</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(2) 其他应收款(续)

(b) 损失准备及其账面余额变动表

	未来 12 个月内预期信用损失 (组合)		第一阶段 未来 12 个月内预期信用损失 (单项)		小计	合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备	坏账准备
	2024 年 12 月 31 日	39,950.00	(6,291.75)	-	-	(6,291.75)
本年新增的款项	51,644,491.27	(79,131.22)	-	-	(79,131.22)	(79,131.22)
本年减少的款项	(46,732,359.66)	3,291.75	-	-	3,291.75	3,291.75
其中：本年收回	(46,732,359.66)	3,291.75	-	-	3,291.75	3,291.75
2025 年 12 月 31 日	4,952,081.61	(82,131.22)	-	-	(82,131.22)	(82,131.22)

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 十六 公司财务报表附注(续)

#### (2) 其他应收款(续)

##### (b) 损失准备及其账面余额变动表(续)

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。处于第一阶段的其他应收款分析如下：

(i) 于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本公司无单项计提坏账准备的其他应收款。

(ii) 于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备		账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例	金额	金额	计提比例
组合一：						
180 天以内	57,170.61	(857.56)	1.50%	19,950.00	(291.75)	1.46%
一到二年	-	-	-	20,000.00	(6,000.00)	30.00%
二年以上	10,000.00	(8,000.00)	80.00%	-	-	-
组合二：						
180 天以内	4,884,911.00	(73,273.66)	1.50%	-	-	-
	<u>4,952,081.61</u>	<u>(82,131.22)</u>		<u>39,950.00</u>	<u>(6,291.75)</u>	

(c) 本年度计提的坏账准备金额为 79,131.22 元，收回的坏账准备金额为 3,291.75 元。

(d) 2025 年度本公司不存在重要的其他应收款的转回或核销情况(2024 年度：无)。

(e) 于 2025 年 12 月 31 日，按欠款方归集的其他应收款分析如下：

	性质	余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
				余额总额比例	
殷封封及其控制的					
持股平台	处置子公司款项	4,884,911.00	180 天以内	98.65%	(73,273.66)
员工	备用金	57,170.61	180 天以内	1.15%	(857.56)
员工	代垫款	10,000.00	二年以上	0.20%	(8,000.00)
		<u>4,952,081.61</u>		<u>100.00%</u>	<u>(82,131.22)</u>

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(3) 长期股权投资

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
子公司(a)	1,943,240,765.41	1,967,310,359.31
联营企业(b)	686,047,839.25	350,511,948.72
	<u>2,629,288,604.66</u>	<u>2,317,822,308.03</u>
减：长期股权投资减值准备	-	-
	<u>2,629,288,604.66</u>	<u>2,317,822,308.03</u>

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 十六 公司财务报表附注(续)

#### (3) 长期股权投资(续)

##### (a) 子公司

	2024 年 12 月 31 日	本年增减变动			2025 年 12 月 31 日	减值准备年末余额	本年宣告分派的现金股利
		追加投资	处置子公司	其他权益变动			
山东有研半导体	1,942,382,412.89	-	-	858,352.52	1,943,240,765.41	-	62,918,204.00
北京艾唯特	24,927,946.42	-	(24,967,990.11)	40,043.69	-	-	-
	<u>1,967,310,359.31</u>	<u>-</u>	<u>(24,967,990.11)</u>	<u>898,396.21</u>	<u>1,943,240,765.41</u>	<u>-</u>	<u>62,918,204.00</u>

##### (b) 联营企业

	2024 年 12 月 31 日	本年增减变动						2025 年 12 月 31 日	减值准备年末余额
		增加投资	减少投资	按权益法调整的 净损失	其他权益变动	其他	计提减值准备		
山东有研艾斯	347,955,148.81	380,000,000.00	-	(49,188,462.63)	132,688.43	-	-	678,899,374.61	-
山东尚泰	2,556,799.91	-	(1,899,324.18)	(657,475.73)	-	-	-	-	-
北京艾唯特(i)	-	9,388,522.97	-	(1,105,040.86)	28,398.98	(1,163,416.45)	-	7,148,464.64	-
	<u>350,511,948.72</u>	<u>389,388,522.97</u>	<u>(1,899,324.18)</u>	<u>(50,950,979.22)</u>	<u>161,087.41</u>	<u>(1,163,416.45)</u>	<u>-</u>	<u>686,047,839.25</u>	<u>-</u>

- (i) 2025 年度，本公司转让其持有的北京艾唯特 49.48%的股权，转让后剩余股权比例为 30.00%。上述交易完成后，本公司不再拥有对北京艾唯特的控制权。本公司有权提名一名董事，参与或影响其财务和经营决策，对北京艾唯特具有重大影响，将其作为联营企业采用权益法核算(附注四(11)、五(1))。本公司对于自设立北京艾唯特至本年年初，北京艾唯特实现的净损失中按 30.00%股权比例应享有的份额，调整期初留存收益 1,163,416.45 元；对于本年年初至处置该投资之日，北京艾唯特实现的净损失中按 30.00%股权比例应享有的份额，调整当期损益 1,105,040.86 元。除净损益外的其他原因导致北京艾唯特其他所有者权益变动中按 30.00%股权比例应享有的份额，调整期初资本公积(其他资本公积)16,385.87 元和资本公积(其他资本公积) 12,013.11 元。

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(4) 营业收入和营业成本

	2025 年度	2024 年度
主营业务收入	149,115,574.60	126,678,243.39
其他业务收入	40,402,958.97	57,509,849.16
	<u>189,518,533.57</u>	<u>184,188,092.55</u>
	2025 年度	2024 年度
主营业务成本	105,777,118.01	83,227,080.78
其他业务成本	12,390,410.20	23,644,474.36
	<u>118,167,528.21</u>	<u>106,871,555.14</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2025 年度		2024 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售商品				
- 半导体硅抛光片	18,028,800.00	17,931,235.33	10,865,000.00	10,727,232.82
- 刻蚀设备用硅材料	45,082,269.12	24,591,845.13	60,839,148.29	33,354,599.80
- 其他	86,004,505.48	63,254,037.55	54,974,095.10	39,145,248.16
	<u>149,115,574.60</u>	<u>105,777,118.01</u>	<u>126,678,243.39</u>	<u>83,227,080.78</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2025 年度		2024 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
技术服务及受托加工收入	39,316,605.71	11,929,687.08	43,411,988.53	16,403,273.64
销售外购商品	150,138.48	-	11,386,056.16	5,606,194.69
租金收入(i)	-	-	1,481,868.00	879,608.04
销售原辅料及废料	936,214.78	460,723.12	1,229,936.47	755,397.99
	<u>40,402,958.97</u>	<u>12,390,410.20</u>	<u>57,509,849.16</u>	<u>23,644,474.36</u>

(i) 本公司的租金收入来自于出租自有房屋及建筑物。

(c) 本公司主营业务收入全部为在某一时点确认。

本公司其他业务收入中外购商品、原辅料及废料销售收入于某一时点确认，技术服务及受托加工收入在某一段时间内确认。

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(5) 投资收益

	2025 年度	2024 年度
成本法核算的长期股权投资收益	62,918,204.00	85,024,600.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,180,103.54	13,279,902.17
处置长期股权投资取得的投资收益	806,119.68	-
权益法核算的长期股权投资损失	<u>(50,950,979.22)</u>	<u>(35,179,165.13)</u>
	<u>24,953,448.00</u>	<u>63,125,337.04</u>

# 有研半导体硅材料股份公司

## 财务报表补充资料

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 一 非经常性损益明细表

	2025 年度	2024 年度
非流动性资产处置收益/(损失)	5,469,714.08	(801,837.86)
除与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响外，计入当期损益的政府补助	65,832,324.92	49,979,644.13
除同正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	33,538,561.74	43,532,345.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	592,054.95	1,017,154.90
	<u>105,432,655.69</u>	<u>93,727,306.41</u>
所得税影响额	(14,488,649.44)	(14,285,028.62)
少数股东权益影响额(税后)	<u>(11,188,188.98)</u>	<u>(9,560,856.38)</u>
	<u>79,755,817.27</u>	<u>69,881,421.41</u>

#### (1) 2025 年度非经常性损益明细表编制基础

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修订)》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

### 二 净资产收益率及每股收益

	加权平均		每股收益			
	净资产收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	2025 年度	2024 年度	2025 年度	2024 年度	2025 年度	2024 年度
归属于公司普通股股东的净利润	4.75%	5.51%	0.17	0.19	0.17	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.94%	3.86%	0.10	0.13	0.10	0.13